

安徽天禾律师事务所

关于合肥新汇成微电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

补充法律意见书（五）



安徽天禾律师事务所

ANHUI TIANHE LAW OFFICE

地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层

电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450

安徽天禾律师事务所
关于合肥新汇成微电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之
补充法律意见书（五）

天律意 2024 第 00956 号

致：合肥新汇成微电子股份有限公司

根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规及中国证监会有关规范性文件的规定，依据发行人与本所签署的《聘请专项法律顾问合同》，本所接受发行人的委托，担任汇成股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问，并指派本所卢贤榕律师、陈磊律师、孙静律师（以下简称“本所律师”）作为经办律师。

本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）》及修订稿（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）、《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）、《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》以下合称“《法律意见书》”。本所

律师对发行人自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称“补充核查期间”）有关重大事项、对《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）（2023）216 号）（以下简称“《问询函》”）所涉及的法律事项更新情况进行了核查，并出具本补充法律意见书。本所就出具本补充法律意见书所声明的事项适用前述已出具的《法律意见书》《律师工作报告》中已声明的事项，本补充法律意见书作为《法律意见书》《律师工作报告》的补充、修正或完善，不一致之处以本补充法律意见书为准，前述已出具《法律意见书》《律师工作报告》中已表述未发生变化的内容，本补充法律意见书不再赘述。

如无特别说明，本补充法律意见书中所涉及到的简称、释义与《法律意见书》《律师工作报告》中的简称、释义具有相同含义，新增的简称、释义如下：

报告期、最近三年	指	2021 年度、2022 年度及 2023 年度
《审计报告》	指	天健会计师对公司 2021 年度、2022 年度以及 2023 年度的财务报表进行审计并出具的“天健审（2022）278 号”、“天健审（2023）2878 号”和“天健审（2024）2278 号”审计报告
《非经常性损益的鉴证报告》	指	天健会计师出具的编号为天健审（2024）5427 号的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》
晶汇聚芯	指	合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限合伙）
晶合汇信	指	合肥晶合汇信私募基金管理有限公司

本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：

第一部分：关于《问询函》的回复

一、《问询函》问题 1 关于本次募投项目

根据申报材料，1)“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”主要针对主营业务前端的金凸块制造（Gold Bumping）环节，提高公司新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造和晶圆测试生产能力，“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”主要针对主营业务后端的玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节；2) 前次募投项目主要针对 LCD 产品封测，而本次募投项目扩产主要针对 OLED 等新型显示驱动芯片产品封测；3) 项目达产后，公司每年新增晶圆金凸块制造 240,000.00 片、晶圆测试 122,400.00 片的生产能力、玻璃覆晶封装 20,400.00 万颗、薄膜覆晶封装 9,600.00 万颗的生产能力；4) 公司前次募投项目包括“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”“研发中心建设项目”和“补充流动资金”；5) 公司募投项目尚未取得环评批复。

请发行人说明：（1）本次募投项目与前次募投项目、公司现有业务的联系和差异，并结合本次募投产品与前次募投产品在技术路径、性能指标、应用领域等方面的比较情况，说明本次募投项目建设是否具有必要性和紧迫性，是否存在重复建设情形；（2）本次募投项目投向 OLED 封测业务的主要考虑，发行人是否具备技术、市场、人员等储备基础，募投项目是否符合投向主业等相关规定；（3）以表格列示本次募投项目实施前后公司产能的变化情况，并结合产品的市场空间、竞争格局、在手订单、产能利用率、前募达产后的市场供给情况、可比公司产能扩张情况等，说明本次募投项目产能规划的合理性以及产能消化措施；（4）本次募投项目环评批复的取得进展、预计取得时间，是否存在实质性障碍。

请发行人律师对（1）（4）进行核查，请申报会计师对（1）（3）进行核查，请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

一、核查情况

（一）本次募投项目与前次募投项目、公司现有业务的联系和差异，并结合

本次募投产品与前次募投产品在技术路径、性能指标、应用领域等方面的比较情况，说明本次募投项目建设是否具有必要性和紧迫性，是否存在重复建设情形

1、本次募投项目与前次募投项目的联系和差异

公司前次募投项目“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”是公司利用现有厂区，在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充，旨在提升公司 12 吋晶圆金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装的产能规模，与本次募投项目均属于公司既有产品的扩产项目。两者的区别在于封测的产品结构不同，前次募投项目主要针对 LCD 产品封测，而本次募投项目扩产主要针对 OLED 等新型显示驱动芯片产品封测，产品结构的变化系第三代显示技术 OLED 具有能耗低、发光率好、亮度高和轻薄等优点，在终端设备中的应用越来越广泛。通过本次募投项目，公司将扩大 OLED 面板的显示驱动封装测试规模，并且拓展车载显示面板市场，从而在传统消费电子领域之外扩大市场份额，提升公司的品牌影响力。

公司前次募投项目“研发中心建设项目”旨在通过建设研发中心及引进先进设备，针对凸块结构优化、测试效率提升、倒装技术键合品质、CMOS 图像传感器封装工艺等加大研发投入，进而提高公司在高端先进封装测试服务领域的研发能力。研发中心建设所带来的公司研发软硬件基础提升为新增产能空间打下良好基础，使得公司积累了大量的工艺技术，为本次募投扩产项目提供扎实的技术支持，可实现项目快速部署投产，有力地提升了公司的整体市场竞争力。

2、本次募投项目与公司现有业务的联系和差异

（1）公司本次募投项目与公司现有业务各维度对比分析

公司本次募投项目和公司现有业务的对比分析如下：

项目	本次募投项目	现有业务
应用领域	本次募投项目扩充产能主要应用于 OLED 等新型显示驱动芯片封装测试业务，封测的晶圆制程一般为 28-40nm	公司现有业务主要应用于 LCD 等显示驱动芯片封装测试业务，封测的晶圆制程一般为 55-150nm，公司现有业务已包含制程在 28-40nm 之间的小部分 OLED 显示驱动芯片封装测试业务

项目	本次募投项目	现有业务
供应商	含金原料、Tray 盘、光刻胶等主要原材料供应商以及高阶测试机、探针台等设备供应商	含金原料、Tray 盘、光刻胶等主要原材料供应商以及测试机、探针台等设备供应商
客户	显示驱动芯片设计公司	显示驱动芯片设计公司
技术路径	采用高端先进封装中的凸块制造、倒装封装（FC）技术	采用高端先进封装中的凸块制造、倒装封装（FC）技术
工艺制程	使用金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装制程，在封装过程中采用非接触式的镭射切割（Laser grooving）技术，对测试机台的测试频率、测试 pin 数量等性能指标要求较高	使用金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装制程，现有 OLED 封测业务在封装过程中已采用镭射切割技术

注：公司使用的镭射切割技术系通过镭射光束聚焦高温气化，将切割道表面的制程金属铜与介电层移除实现切割效果，当晶圆制程低于 50nm 时对切割的精密度和稳定性要求更高，通常需要使用非接触式的镭射切割技术，公司现有 OLED 封测业务在封装过程中已掌握和采用镭射切割技术。

如上表所示，在应用领域方面，公司本次募投项目主要应用于 OLED 等新型显示驱动芯片封测业务，公司现有业务主要应用于 LCD 等显示驱动芯片封测业务，OLED 等新型显示驱动芯片封测的晶圆制程一般为 28-40nm，本次募投项目和现有 LCD 显示驱动芯片封测业务在晶圆制程上存在一定差异，但公司现有业务已包含制程在 28-40nm 之间的小部分 OLED 显示驱动芯片封测业务；在客户和供应商方面，公司本次募投项目和现有业务的客户和供应商不存在明显差异；在技术路径和工艺制程方面，公司本次募投项目和现有业务均使用金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装制程，均属于高端先进封装技术，技术路径相似，但本次募投项目和现有 OLED 封测业务需要使用非接触式的镭射切割（Laser grooving）技术，并且对测试机台的测试频率、测试 pin 数量等性能指标要求较高。

（2）公司已具备 OLED 显示驱动芯片封测能力，本次募投项目系公司对现有 OLED 显示驱动芯片封测业务产能的扩充

公司是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域，具有领先的行业地位。公司主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，

并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于 LCD、AMOLED 等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。公司目前已具备 OLED 显示驱动芯片封测能力，2021 年起逐步导入 OLED 显示驱动芯片封测业务，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
OLED 显示驱动芯片封测业务收入	14,829.01	2,977.45	4,407.38
主营业务收入	116,845.37	88,438.82	76,593.90
占比	12.69%	3.37%	5.75%

2021 年度至 2023 年度，公司 OLED 显示驱动芯片封测业务收入分别为 4,407.38 万元、2,977.45 万元及 14,829.01 万元，占主营收入比例分别为 5.75%、3.37% 及 12.69%，OLED 显示驱动芯片封测业务客户需求在 2023 年以来呈现快速增长的需求。此外，截至 2024 年 3 月末，公司在手订单金额为 6,336.81 万元，在手订单充足，其中随着客户对 OLED 显示驱动芯片封测需求提升，OLED 显示驱动芯片封测在手订单金额为 900.07 万元，占比达 14.20%，相较于公司 2023 年度 OLED 显示驱动芯片封测业务收入占比 12.69% 进一步提升。

综上所述，公司本次募投项目“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”和“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”均围绕现有主营业务展开，结合当前 OLED 等新型显示驱动芯片市场需求和技术发展趋势，通过购置先进的设备和软件，开展新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造、晶圆测试服务，扩充公司 OLED 显示驱动芯片封测产能。本项目建成后，将有效提升公司 OLED 等新型显示驱动芯片的封测服务规模，为公司未来业务发展提供可靠的扩产基础，巩固公司在显示驱动芯片封测领域的领先地位，提高市场份额。本次募集资金投资建设项目系公司为顺应产业发展趋势、响应下游客户日益扩张的产品需求而做出的重要布局，有助于扩大业务规模，巩固市场地位。公司本次募投项目符合《上市公司证券发行注册管理办法》

第四十条关于“本次募集资金主要投向主业”的规定。

3、本次募投产品与前次募投产品在技术路径、性能指标、应用领域等方面的比较情况

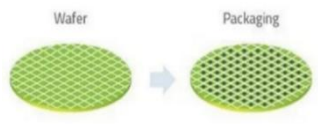
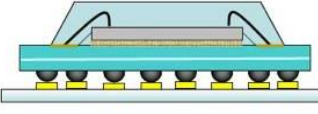
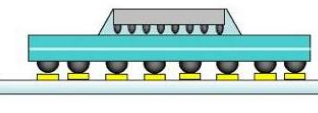
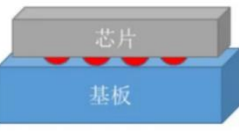
（1）应用领域

公司前次募投主要针对 LCD 显示驱动芯片封测，本次募投项目系公司为顺应行业发展趋势，满足 OLED 显示驱动芯片快速增长的市场需求而进行建设；LCD 显示面板广泛应用于各类消费电子、工业控制、汽车电子等终端产品，在大尺寸面板市场仍为主流显示技术；而 OLED 显示面板则主要应用于智能手机、笔记本、平板电脑、车载、智能穿戴等中小尺寸面板市场，因此公司前次募投和本次募投在产品应用领域方面存在一定差异。

（2）技术路径和测试性能指标

自封装技术出现以来，经历了较长的发展过程，形成了多样化的封装形式，具体可以分为以下阶段：

阶段	时间	封装技术	具体封装形式	图示
第一阶段（传统封装）	20 世纪 70 年代前	通孔插装型封装	晶体管封装（TO）、双列直插封装（DIP）、陶瓷双列直插封装（CDIP）、塑料双列直插封装（PDIP）、单列直插式封装（SIP）	
第二阶段（传统封装）	20 世纪 80 年代以后	表面贴装型封装	塑料有引线片式载体封装（PLCC）、四边引脚扁平封装（QFP）、塑料四边引线扁平封装（PQFP）、小外形表面封装（SOP）、无引线四边扁平封装（PQFN）、小外形晶体管封装（SOT）、双边扁平无引脚封装（DFN）	
第三阶段（先进封装）	20 世纪 90 年代以后	面积阵列型封装	球栅阵列封装（BGA）、塑料焊球阵列封装（PBGA）、陶瓷焊球阵列封装（CBGA）、带散热器焊球阵列封装（EBGA）、倒装芯片焊球阵列封装（FC-BGA）	

		晶圆级封装（WLP）	
		芯片级封装（CSP）	
第四阶段（先进封装）	20 世纪末开始	多芯组装（MCM）、系统级封装（SiP）、三维立体封装（3D）、凸块制造（Bumping）	 以凸点（Bumping）为例
第五阶段（先进封装）	21 世纪前 10 年开始	系统级单芯片封装（SoC）、微电子机械系统封装（MEMS）、晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）、倒装封装（FC）、扇外型封装（Fan-out）	 以倒装（FC）为例

资料来源：《中国半导体封装业的发展》、Frost & Sullivan，海通证券整理。

在技术路径方面，公司工艺制程中的金凸块制造属于第四阶段封装技术，而玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装属于第五阶段中的倒装封装（FC）技术，均为高端先进封装技术。

公司本次募投产品 OLED 显示驱动芯片封测业务和前次募投产品 LCD 显示驱动芯片封测业务均使用金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装制程，技术路径相似，均属于高端先进封装技术，但在工艺制程及设备性能要求方面存在一定区别，具体情况如下：

一方面，与 LCD 显示驱动芯片相比，由于 OLED 显示驱动芯片在晶圆制造环节需要使用 low-k（低介电常数）技术和铜制程，导致封装过程中采用传统刀片切割易于造成电路表面崩裂、硅层暗裂等问题，因此需要采用非接触式的镭射切割（Laser grooving）技术，将表面电路层进行气化，再使用传统刀片对晶圆硅层进行切割。由于显示驱动芯片封测过程中晶圆切割的精密度和稳定性对成品率和封装效率有着重要影响，因此 OLED 显示驱动芯片封测业务对封测厂商的工

艺制程提出了更高的要求。

另一方面，OLED 显示驱动芯片封测业务与 LCD 显示驱动芯片封测业务在性能指标方面的差异主要体现在晶圆测试环节对于测试机台的性能要求，具体比较情况如下：

类型	封测晶圆制程	测试频率	测试 pin 数量
LCD	DDIC: 110-150nm TDDI: 55-90nm	500Mb-2.5Gsps	1280-2304
OLED	28-40nm	2.7-6.3Gsps	2304-3584

如上表所示，OLED 显示驱动芯片封测对于晶圆测试环节使用的测试机台的测试频率、测试 pin 数量等性能指标要求较高，公司现有高阶测试机台数量不能有效满足日益增长的 OLED 显示驱动芯片封测需求，因此公司本次募投项目主要投向 OLED 显示驱动芯片封测领域，具有合理性。

4、本次募投项目建设是否具有必要性和紧迫性，是否存在重复建设情形

综上所述，公司前次募投项目主要针对 LCD 产品封测，而随着 OLED 面板在手机、笔记本/平板电脑、车载、智能穿戴等中小尺寸面板市场渗透率快速提升，本次募投项目围绕公司主营业务展开，在现有业务基础上主要针对 OLED 等新型显示驱动芯片产品封测业务进行扩产，本次募投项目建设具有必要性和紧迫性，不存在重复建设的情形。

（二）本次募投项目环评批复的取得进展、预计取得时间，是否存在实质性障碍

发行人本次募集资金主要用于“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”和“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”。截至本补充法律意见书出具日，发行人本次募投项目环评手续办理进展及预计取得时间如下：

序号	项目名称	最新进展情况	预计取得时间
----	------	--------	--------

序号	项目名称	最新进展情况	预计取得时间
1	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	发行人已于 2023 年 10 月 8 日取得合肥市生态环境局出具的环评批复	已取得环评批复“环建审（2023）12038 号”
2	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	发行人已于 2023 年 10 月 20 日取得扬州市生态环境局出具的环评批复	已取得环评批复“扬环审批（2023）05-51 号”

如上表所示，发行人已于 2023 年 10 月 8 日取得合肥市生态环境局出具的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目环境影响报告表审批意见的函》（环建审（2023）12038 号），已于 2023 年 10 月 20 日取得扬州市生态环境局出具的《关于江苏汇成光电有限公司 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目环境影响报告表的批复》（扬环审批（2023）05-51 号）。

发行人本次募投项目在现有厂区进行建设，发行人厂区配置有完善的废水、废气、固废处理设施，运营期间将严格执行并落实节能与环境保护的相关制度措施，对设备采用减振、隔音等噪声防治措施，确保各项环保措施使用可靠，预计项目投产后不会对大气及地表水生态环境产生较大影响，不会对本次发行构成实质性障碍。

二、核查过程

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得并查阅发行人本次募投项目与前次募投项目的可行性研究报告，了解本次募投项目发行人新增产能情况，分析本次募投项目与前次募投项目、公司现有业务的联系和差异；

2、访谈发行人管理层，了解本次募投项目与前次募投项目、公司现有业务的联系和差异，分析本次募投产品与前次募投产品在技术路径、性能指标、应用领域等方面的比较情况；

3、获取发行人针对本次募投项目编制的《建设项目环境影响报告表》和本次募投项目的环评批复，访谈发行人管理层，了解本次募投项目环评批复的进展情况。

三、核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人前次募投项目主要针对 LCD 产品封测，本次募投项目继续围绕发行人主营业务展开，在现有业务基础上主要针对 OLED 等新型显示驱动芯片产品封测业务进行扩产，两者均使用高端先进封装技术，但本次募投项目对发行人工艺制程和测试机台性能要求相对前次募投更高，因此本次募投项目建设具有必要性和紧迫性，不存在重复建设的情形；

2、发行人已取得本次募投项目的环评批复，发行人本次募投项目投产后预计不会对大气及地表水生态环境产生较大影响，不会对本次发行构成实质性障碍。

二、《问询函》问题 2 关于前次募投项目

根据申报材料，1) 公司前次募投项目“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间，分别由 2022 年 12 月、2023 年 6 月延长到 2023 年 12 月、2023 年 9 月；2) 公司未针对前次募投项目“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”新增产能另设单独的管理、核算体系，故无法直接单独核算募投项目的经济效益，但认为该募投项目已达到预计效益。

请发行人说明：（1）前次募投延期的原因及合理性，相关因素是否属于在申请前次募集资金时可以合理预计，募投项目延期是否履行了法定审议程序，在前募项目未建设完毕的情况下，再次申请进行融资建设的必要性及合理性；（2）结合前次募集资金的使用进展，说明后续使用计划，是否按计划进行；（3）结合前次关于募投项目的效益测算情况，说明公司认为前次募投项目达到预计效益的具体依据。

请发行人律师对（1）（2）进行核查，请申报会计师对（3）进行核查，请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

一、核查情况

（一）前次募投延期的原因及合理性，相关因素是否属于在申请前次募集资金时可以合理预计，募投项目延期是否履行了法定审议程序，在前募项目未建设完毕的情况下，再次申请进行融资建设的必要性及合理性

1、前次募投延期的原因及合理性，相关因素是否属于在申请前次募集资金时可以合理预计

公司前次募投项目“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间存在延期情形，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	2022 年 12 月	2023 年 12 月
研发中心建设项目	2023 年 06 月	2023 年 09 月

注：截至 2023 年 9 月末，公司前次募集资金已全部使用完毕。

公司前次募投项目建设的主要内容为集成电路封装测试设备购置、安装及调试，设备采购的下单时间及付款时间直接影响着募集资金使用和募投项目实施进度。

“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”所需购置设备以高值、先进的测试机、探针台等进口设备为主，公司发出采购订单后，设备供应商备货时间周期较长，以 ADVANTEST 的 ND4 测试机台和东京精密的探针台为例，从公司下达采购订单至设备到货周期一般为 8-12 个月，特别是 2021 年末半导体市场整体景气度较高，设备供应商在手订单数量有所增长，部分前述高阶设备产能较为紧张，且公司采购数量较多，在设备供应商产能有限的情况下导致了设备交期进一步延长至 15-20 个月，故而导致项目延期。

“研发中心建设项目”实施过程中的设备选型及安装调试工作不断优化，同时受国内外经济环境的持续影响，公司在实施项目的过程中相对谨慎，根据下游市场及客户需求的变化适时调整项目实施进度及研发方向，加大了新能源车载芯片领域的研发投入，且 2022 年 12 月至 2023 年 1 月公司和设备供应商的有效工

作时间均受到明显不利影响，导致公司研发设备下单和交付时间晚于预期计划 2-3 个月，故而导致项目延期。

公司前次募投项目延期主要受供应商在手订单数量、宏观外部环境、下游市场及客户需求等无法在申请前次募集资金时可以合理预计的客观因素影响，导致项目的建设进度延缓，具有合理性。

截至 2023 年 9 月末，公司前次募集资金已全部使用完毕，研发中心建设项目已实施完毕；截至 2023 年 12 月末，12 吋显示驱动芯片封测扩能项目已实施完毕。

2、募投项目延期是否履行了法定审议程序

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延期，履行了法定审议程序。

前次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。前次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

3、在前募项目未建设完毕的情况下，再次申请进行融资建设的必要性及合理性

（1）截至 2023 年 6 月末前募项目整体投入进度超过 90%，实现的效益高于预期效益

受外部因素影响，虽然公司前次募投项目“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”有所延期，但截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募投项目募集资金整体投入进度为 93.44%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募

投项目已建设完毕。同时，据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕5428号），截至2023年12月31日，前次募投项目累计实现的效益为12,550.91万元，前次募投项目实现的效益高于申请前次募集资金时预计的预期效益。

（2）本次募投项目与前次募投项目在性能指标、下游应用等方面存在差异

本次募投项目与前次募投项目在性能指标、下游应用等方面存在差异具体参见本补充法律意见书“问题1关于本次募投项目”之“（一）本次募投项目与前次募投项目、公司现有业务的联系和差异，并结合本次募投产品与前次募投产品在技术路径、性能指标、应用领域等方面的比较情况，说明本次募投项目建设是否具有必要性和紧迫性，是否存在重复建设情形”。

（3）本次募投项目基于快速增长的市场需求

在市场需求方面，近年来OLED显示屏市场渗透率快速提升，根据Frost & Sullivan数据，2020年全球OLED显示驱动芯片出货量达到14.0亿颗，预计2025年全球OLED显示驱动芯片出货量达24.5亿颗，市场占比达到10.5%。

公司作为专业从事于晶圆测试和封装的企业，在显示驱动芯片封测行业深耕多年，具备丰富的产品经验和服技术经验。针对市场发展趋势，公司计划扩大在OLED领域的产能配置，但是公司当前的设备配置无法满足OLED显示驱动芯片需求快速增长的生产需要。为抓住市场机遇，公司计划引进先进高效的生产设备，提升OLED产品封装测试能力，满足OLED显示驱动芯片快速增长的市场需求，进一步提升公司在显示驱动芯片领域的竞争优势。

本次募投项目的实施，有利于扩大公司的市场占有率，进一步提升公司竞争优势，提升可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益，提高公司经营业绩和盈利能力。

（4）集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，公司自有资金无法满足本次募投项目资金需求

公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，要形成规模化生产，

需要进行大规模的固定资产投资，且回报周期较长。结合集成电路封装测试行业的特殊性，公司本次再融资符合行业特性。截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金、交易性金融资产余额及一年内到期的非流动资产中理财产品余额合计为 14,078.30 万元，扣除受限货币资金及募集资金专户资金余额，公司可自由支配资金为 14,028.05 万元。综合考虑公司日常经营、长期资产投资等需求，公司自有资金无法满足本次募投项目需求，存在 143,357.79 万元的资金缺口。

综上所述，截至 2023 年 12 月 31 日公司前募项目已建设完毕，在截至 2023 年 6 月 30 日前募项目整体投入进度超过 90% 且实现的效益高于预期效益前提下，本次募投项目又与前次募投项目在性能指标、下游应用等方面存在差异，同时，基于快速增长的市场需求且有利于保持公司的竞争优势，结合集成电路封装测试行业的特殊性，公司本次再融资符合行业特性，在截至 2023 年 6 月 30 日前募项目未建设完毕的情况下，再次申请进行融资建设，具有必要性及合理性。

（二）结合前次募集资金的使用进展，说明后续使用计划，是否按计划进行

由于前次募投项目部分设备供应商备货时间周期较长，特别是部分高阶设备产能较为紧张，设备供应商在手订单较多，进一步延长了设备交期，“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”均有所延期，致使截至 2023 年 6 月 30 日部分前次募集资金尚未使用完毕。公司对于截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的前次募集资金已制定了明确的后续使用计划，具体如下所示：

单位：万元

项目名称	截至 2023 年 6 月 30 日 已投入金额	2023 年 7 月-12 月 计划投入金额	合计
12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	69,583.12	8,416.88	78,000.00
研发中心建设项目	4,757.57	242.43	5,000.00
合计	74,340.69	8,659.31	83,000.00

如上表所示，截至 2023 年 6 月 30 日，公司首发募集资金整体投入进度为 93.44%，其中“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”募集资金投入进度为 89.21%，“研发中心建设项目”募集资金投入进度为 95.15%，与项目规划建设进度相符，虽然截至 2023 年 6 月 30 日公司前次募集资金尚未使用完毕，但尚未使用的前次

募集资金已经设定预计使用用途并按使用计划执行。

截至 2023 年 9 月末，公司前次募集资金已全部使用完毕。

二、核查过程

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、查阅发行人前次募投项目的可行性研究报告、前次募集资金使用情况鉴证报告、证监会的相关规定等，了解公司前次募投项目投入计划及使用进度；
- 2、查阅发行人关于前次募投项目延期的相关公告及董事会文件；
- 3、访谈发行人管理层，了解前次募投项目的内外部经营环境变化情况；
- 4、实地查看前次募投项目的建设情况，并对相关负责人进行访谈，了解前次募投项目的建设进展、变更及建设延期的原因。

三、核查意见

经核查，本所律师认为：

- 1、公司前次募投项目延期主要受供应商在手订单数量、宏观外部环境、下游市场及客户需求等因素影响，导致项目的建设进度延缓，具有合理性；
- 2、公司前次募投项目延期已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，履行了法定审议程序；
- 3、截至 2023 年 12 月 31 日公司前募项目已实施完毕，本次募投项目与前次募投项目在性能指标、下游应用等方面存在差异，同时，基于快速增长的市场需求且有利于保持公司的竞争优势，结合集成电路封装测试行业的特殊性，公司本次再融资符合行业特性，在截至 2023 年 6 月 30 日前募项目整体投入进度超过 90%且实现的效益高于预期效益情况下，再次申请进行融资建设，具有必要性及合理性。

三、《问询函》问题 6 关于其他

6.1 根据申报材料，截至 2023 年 3 月末，实际控制人存在大额负债，合计 30,415.10 万元，同时还存在因个人资金周转需要产生的对外借款 379.73 万元。

请发行人说明：结合前述借款背景、用途、偿还能力，说明实际控制人大额负债对公司控制权稳定性的影响，是否会产生重大不利影响。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

一、核查情况

（一）结合前述借款背景、用途、偿还能力，说明实际控制人大额负债对公司控制权稳定性的影响，是否会产生重大不利影响

1、借款背景

公司所处行业为资金密集型行业，固定资产投资规模较大，公司实际控制人郑瑞俊为支持公司发展资金需求较大，存在以个人名义对外借款的情形。截至本补充法律意见书出具日，实际控制人相关大额对外借款的具体情况如下：

单位：万元

债权人	借款本金（折合人民币）	借款利率	到期时间
黄明端	4,996.96	年利率 5%	2025 年 1 月
童富	2,378.67	年利率 5%	2025 年 1 月
张兆文	8,400.00	年利率 5%	2026 年 7 月
	14,639.47	年利率 5%	2026 年 9 月
合计	30,415.10	-	-

注：外币折合人民币按实际交易发生日的汇率计算。

除上述负债外，截至本补充法律意见书出具日，实际控制人还存在因个人资金周转需要产生的对外借款，具体情况如下：

单位：万元

债权人	借款本金（折合人民币）	借款利率	到期时间
孙瑞芬	379.73	未约定	未约定
合计	379.73	-	-

注：外币折合人民币按实际交易发生日的汇率计算。

（1）对黄明端的负债情况

A.对黄明端负债的原因及背景

黄明端为中国台湾人士，现担任高鑫零售（6808.HK，旗下持有“大润发”、“欧尚”等知名连锁卖场）董事会主席。黄明端系两岸经贸界知名人士，个人具有对外投资的能力和意愿。黄明端及其配偶控制的 Worth Plus 于 2019 年 9 月通过增资及受让股权的形式入股汇成有限。

黄明端与郑瑞俊相识多年，在 Worth Plus 入股公司前，因公司持续投入规模较大，资金需求较多，郑瑞俊以个人名义向其借款用于公司及个人周转。自 2018 年 2 月起，黄明端陆续向郑瑞俊提供借款，截至本补充法律意见书出具日，郑瑞俊向黄明端借款余额折合人民币约为 4,996.96 万元。根据双方约定，借款期限至 2025 年 1 月 1 日止，年利率 5%，到期一次性还本付息。

B.对黄明端负债的具体形成过程及偿还情况

截至本补充法律意见书出具日，郑瑞俊对黄明端负债的具体形成过程及偿还情况如下：

单位：万元

事项	时间	借款/还款情况			累计借款余额			还款期限
		币种	金额	折合人民币金额	人民币	美元	折合人民币合计	
第一次借款	2018年2月	美元	400.00	2,503.84	-	400.00	2,503.84	2025.01
	2018年2月	人民币	1,696.16	1,696.16	1,696.16	400.00	4,200.00	
	小计				4,200.00	1,696.16	400.00	
第二次借款	2018年8月	美元	300.00	2,053.13	1,696.16	700.00	6,253.13	2025.01
	2018年9月	美元	415.98	2,846.87	1,696.16	1,115.98	9,100.00	
	小计				4,900.00	1,696.16	1,115.98	
还款	2019年8月	美元	-185.38	-1,305.83	1,696.16	930.60	7,794.17	-
	2019年9月	美元	-300.00	-2,126.49	1,696.16	630.60	5,667.68	
	2019年11月	美元	-95.78	-670.72	1,696.16	534.81	4,996.96	
	小计				-4,103.04	1,696.16	534.81	

注：美元按实际交易发生日的汇率折合人民币。

（2）对童富的负债情况

A.对童富负债的原因及背景

童富为中国台湾人士，因在中国大陆及中国台湾地区经商多年，存在一定的资金积累，具有对外投资的能力和意愿。童富及其近亲属控制的 Great Title 于 2019 年 9 月通过增资及受让股权的形式入股汇成有限。

郑瑞俊向童富借款的原因和背景与黄明端相似。自 2016 年 12 月起，童富陆续向郑瑞俊提供借款，截至本补充法律意见书出具日，郑瑞俊向童富借款余额折合人民币约为 2,378.67 万元。根据双方约定，借款期限至 2025 年 1 月 1 日止，年利率 5%，到期一次性还本付息。

B.对童富负债的具体形成过程及偿还情况

截至本补充法律意见书出具日，郑瑞俊对童富负债的具体形成过程及偿还情况如下：

单位：万元

事项	时间	借款/还款情况			累计借款余额			还款期限
		币种	金额	折合人民币金额	人民币	美元	折合人民币合计	
借款	2016 年 12 月	人民币	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	2025.01
借款	2018 年 1 月	美元	100.00	634.00	1,500.00	100.00	2,134.00	-
还款	2018 年 2 月	人民币	-634.00	-634.00	866.00	100.00	1,500.00	-
借款	2018 年 2 月	人民币	4,400.00	4,400.00	5,266.00	100.00	5,900.00	2025.01
借款	2018 年 7 月	美元	300.00	1,996.90	5,266.00	400.00	7,896.90	2025.01
	2018 年 12 月	美元	23.00	153.10	5,266.00	423.00	8,050.00	
	小计			2,150.00	5,266.00	423.00	8,050.00	
还款	2019 年 8 月	人民币	-2,920.30	-2,920.30	2,345.70	423.00	5,129.70	-
借款	2019 年 8 月	人民币	520.49	520.49	2,866.19	423.00	5,650.19	2025.01
还款	2019 年 9 月	人民币	-10.00	-10.00	2,856.19	423.00	5,640.19	-
	2019 年 10 月	美元	-240.00	-1,698.19	2,856.19	183.00	3,942.00	
	2019 年 11 月	美元	-184.00	-1,295.08	2,856.19	-	2,856.19	
	2019 年 11 月	人民币	-477.52	-477.52	2,378.67	-	2,378.67	

事项	时间	借款/还款情况			累计借款余额			还款期限
		币种	金额	折合人民币金额	人民币	美元	折合人民币合计	
	小计			-3,480.80	2,378.67	-	2,378.67	

注：美元按实际交易发生日的汇率折合人民币。

（3）对张兆文的负债情况

A.对张兆文负债的原因及背景

张兆文为中国台湾人士，因在中国大陆及中国台湾地区经商多年，存在一定的资金积累，具有对外投资的能力和意愿。张兆文近亲属控制的 Advance 于 2020 年 3 月通过增资的形式入股汇成有限。

郑瑞俊向张兆文借款的原因和背景与黄明端相似。自 2018 年 5 月起，张兆文陆续向郑瑞俊提供借款，截至本补充法律意见书出具日，郑瑞俊向张兆文借款余额折合人民币约为 23,039.47 万元。根据双方约定，借款期限为 2026 年 7 月及 2026 年 9 月，年利率 5%，到期一次性还本付息。

B.对张兆文负债的具体形成过程及偿还情况

截至本补充法律意见书出具日，郑瑞俊对张兆文负债的具体形成过程及偿还情况如下：

单位：万元

事项	借款时间	借款情况			累计借款余额				还款期限
		币种	借款金额	折合人民币金额	人民币	美元	新台币	折合人民币合计	
第一次借款	2018 年 5 月	人民币	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	2026.07
	2018 年 9 月	人民币	3,000.00	3,000.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	2018 年 10 月	人民币	1,200.00	1,200.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	2019 年 3 月	人民币	1,500.00	1,500.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	2019 年 5 月	人民币	1,000.00	1,000.00	8,200.00	-	-	8,200.00	
	2019 年 9 月	人民币	200.00	200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	小计				8,400.00	8,400.00	-	-	

第二次 借款	2021年8月	美元	500.00	3,240.23	8,400.00	500.00	-	11,640.23	2026.09
	2021年8月	新台币	1,000.00	231.30	8,400.00	500.00	1,000.00	11,871.53	
	2021年9月	美元	150.00	967.94	8,400.00	650.00	1,000.00	12,839.47	
	2021年9月	人民币	10,200.00	10,200.00	18,600.00	650.00	1,000.00	23,039.47	
	小计				14,639.47	18,600.00	650.00	1,000.00	

注：美元、新台币按实际交易发生日的汇率折合人民币。

（4）对孙瑞芬的借款情况

孙瑞芬为中国台湾人士，在中国大陆及中国台湾地区经商多年，系郑瑞俊相识多年的好友，其未直接或间接持有公司股份，且与公司的客户、供应商均不存在关联关系。

郑瑞俊因个人资金周转需要，向孙瑞芬借入新台币用于在中国台湾地区的家庭开支，截至本补充法律意见书出具日，郑瑞俊对孙瑞芬的借款余额为 1,630.21 万新台币，折合人民币 379.73 万元。前述借款未约定明确的借款利率及还款期限。

2、借款用途

（1）实际控制人对外借款于 2016-2018 年期间初步形成，取得借款后主要用于向发行人提供借款

2016-2018 年，发行人合肥封测基地开始建设并逐步投产，因固定资产投资规模较大，存在较大的资金需求，实际控制人郑瑞俊以个人名义向黄明端、童富、张兆文等人借款，主要系用于以股东借款的形式投入发行人以满足其经营周转需要。

2018 年下半年，发行人股东合肥创投拟退出部分股权，由控股股东扬州新瑞连回购该等股权。由于实际控制人及相关方已将主要资金用于向发行人提供借款，同时考虑到支持发行人持续发展的需要，合肥创投同意前述股权转让款可分期支付，最晚于 2021 年末前付清，同时实际控制人及相关方需向发行人提供无息借款，具体情况详见“（3）实际控制人对外借款最终去向主要为回购部分股东退出股权以及为员工持股平台支付增资款”之“A.向合肥创投支付股权转让款并

向发行人提供借款以支持公司发展”部分。

基于以上背景，为支持发行人发展，2018年末、2019年末，实际控制人及相关方向发行人提供的借款余额均超过1.70亿元，2018-2021年期间，累计向发行人提供借款超过4亿元。

（2）实际控制人于2021年新增对外借款，取得借款后主要用于向合肥创投支付股权转让款

随着经营情况持续向好，发行人于2021年7月前向实际控制人及相关方陆续归还完毕全部借款，实际控制人及相关方自发行人回收资金后陆续向合肥创投分期支付股权转让款。

同时，2021年，实际控制人郑瑞俊以个人名义向张兆文新增借款折合人民币14,639.47万元，在收到借款后主要用途系向合肥创投支付股权转让款。

（3）实际控制人对外借款最终去向主要为回购部分股东退出股权以及为员工持股平台支付增资款

在发行人向实际控制人及相关方归还全部借款后，实际控制人及相关方仍存在大额负债，系由于实际控制人对黄明端等人的借款最终去向主要为回购部分股东退出股权以及为员工持股平台支付增资款，具体情况如下：

单位：万元

最终去向	金额
向合肥创投支付股权转让款	20,606.66
为员工持股平台支付增资款	5,899.25
向嘉兴高和支付股权转让款	7,078.18
合计	33,584.09

由上表可知，借款资金主要的去向已覆盖实际控制人对外负债余额。相关负债的具体用途、最终去向及支持发行人发展的情况具体分析如下：

A.向合肥创投支付股权转让款并向发行人提供借款以支持公司发展

2016年11月，为落地合肥市政府的招商引资政策，为汇成有限建设与发展合肥封测基地提供资金支持，合肥创投作为政府引导基金入股汇成有限，以2.50

元/注册资本的价格认购汇成有限 8,000 万元新增注册资本，增资总额为 20,000 万元。合肥创投入股时与彼时汇成有限原股东签署书面投资协议，约定自合肥创投增资完成之日（即 2016 年 11 月 17 日）起 60 个月内，扬州新瑞连等原股东有权回购合肥创投持有的部分或全部汇成有限股权；前述 60 个月期限届满后，扬州新瑞连等原股东应当根据合肥创投的书面通知回购其持有的部分或全部汇成有限股权¹。

2018 年 10 月，合肥创投基于国有资产监管要求的考虑拟退出部分公司股权。经扬州新瑞连与合肥创投协商一致，约定扬州新瑞连回购合肥创投持有的汇成有限 6,800 万元股权，转让价格为转让股权对应的合肥创投投资本金 17,000 万元附加相应利息，实际支付股权转让款项为 20,606.66 万元。

因汇成有限固定资产投资规模较大，存在较大的资金需求，控股股东及实际控制人已于 2016-2018 年期间为发行人提供大量股东借款（资金来源之一系实际控制人郑瑞俊以个人名义向黄明端、童富、张兆文等人的借款），如若向合肥创投支付全部股权转让款项，需先由发行人向控股股东及实际控制人归还大额借款，可能对公司经营现金流造成重大不利影响。同时，合肥创投作为政府引导基金，并非主要以盈利为目的的财务投资者，为充分支持发行人持续发展，双方约定前述股权转让款项分四期于 2021 年 12 月 27 日前付清，具体支付安排如下：

序号	支付时间	约定支付金额
1	2018 年 12 月 31 日前	1,000 万元及相应利息
2	2019 年 12 月 31 日前	2,000 万元及相应利息
3	2020 年 12 月 31 日前	3,000 万元及相应利息
4	2021 年 12 月 27 日前	11,000 万元及相应利息

各方同时约定，扬州新瑞连需向公司提供不低于 17,000 万元的无息借款以作为股权转让款项分期支付的对价。基于前述约定及相关背景，为支持公司发展，2018 年末、2019 年末，实际控制人及相关方向公司提供的借款余额均超过 1.70 亿元，2018-2021 年期间，累计向公司提供借款超过 4 亿元。

B.为员工持股平台支付增资款以吸引优秀人才和维持团队稳定

¹ 合肥创投已于 2021 年 7 月 1 日出具书面确认，确认前述原股东回购条款效力终止。

从公司成立至 2019 年，公司已持续亏损多年，为吸引优秀人才和维持团队稳定，公司拟进行股权激励。考虑到彼时员工出资意愿不强、公司持续发展存在较大的资金需求，且为兼顾其他股东的利益，实际控制人通过员工持股平台以公允价格先行增资入股，此后在实施股权激励时以零元对价授予激励对象。

公司于 2019 年实施员工股权激励时，员工持股平台香港宝信、合肥芯成分别认缴公司新增注册资本 1,250.00 万元、1,109.70 万元，增资价格均为 2.5 元/注册资本，增资款项合计 5,899.25 万元，均由实际控制人出资。

C.向嘉兴高和支付股权转让款避免因股东退出导致减资从而影响发行人发展

2018 年，杨绍校因考虑到其投资江苏汇成及汇成有限的时间较长，拟退出部分股权并回收投资。彼时公司已持续亏损多年，经营资金较为紧张，于是郑瑞俊、杨会夫妇作为实际控制人，受让嘉兴高和持有的部分股权以实现其退出。

实际控制人及相关方受让嘉兴高和持有的汇成有限 5.22% 股权（对应出资额 2,359.39 万元），转让及实际支付总价为 7,078.18 万元。

3、还款能力

实际控制人郑瑞俊从事企业经营时间较长，有一定的经营积累及融资能力，资信状况良好。郑瑞俊、杨会夫妇现持有众多投资资产，可以通过资产处置变现、所投资公司分红以及借助相关资产进行融资等多种方式进行资金筹措，偿债能力较强。

截至本补充法律意见书出具日，除发行人及持有发行人股份的主体外，郑瑞俊、杨会夫妇主要对外投资情况如下：

出资人	被投资企业名称	注册资本	持股比例（%）
郑瑞俊	瑞成建筑	700 万美元	80.00
	百瑞发投资	700 万新台币	直接持股：50.96 香港瑞仕持股：48.97
	天虹科技	60,677.26 万新台币	直接持股：6.37 百瑞发投资持股：5.74
杨会	邦盛聚泽	5,880 万元	9.98

出资人	被投资企业名称	注册资本	持股比例（%）
	邦盛聚沣	8,100 万元	37.04

上述主要投资企业的具体情况如下：

（1）瑞成建筑

瑞成建筑系郑瑞俊实际控制的企业，主要从事建筑工程承包业务，承建了众多工业、住宅、商业地产项目，现持有位于上海漕河泾开发区超过 1,000 m² 的物业。

（2）百瑞发投资、天虹科技

截至本补充法律意见书出具日，郑瑞俊直接持有天虹科技 6.37% 的股份，其实际控制的百瑞发投资持有天虹科技 5.74% 的股份。

天虹科技系中国台湾上市公司（股票代码：6937.TWO），是一家专业集成电路设备制造商，为台积电、联电等知名晶圆厂及封测企业的设备供应商，截至本补充法律意见书出具日，市值约 150 亿元新台币。据此测算郑瑞俊和百瑞发投资持有天虹科技的市值约 18 亿元新台币，折合人民币约 4 亿元。

（3）邦盛聚泽、邦盛聚沣

邦盛聚泽、邦盛聚沣（以下合称“邦盛系基金”）均为南京邦盛投资管理有限公司及其关联方（以下简称“邦盛资本”）实际控制和管理的私募基金。截至本补充法律意见书出具日，杨会对邦盛系基金投资金额超过 3,000 万元，已获得收益分配金额超过 2,000 万元。邦盛系基金已有剑桥科技（603083）、越博动力（300742）、鼎胜新材（603876）、商络电子（300975）等投资项目完成上市，另有苏州海光芯创光电科技股份有限公司、浩德科技股份有限公司等多个投资项目，相关项目通过上市等途径退出后，预计未来邦盛系基金可向杨会分配较高的投资收益。

除上述持有资产外，郑瑞俊、杨会夫妇另持有位于上海等地多套不动产（含别墅）及一定金额的理财产品等金融资产，且公司成功上市后，实际控制人融资渠道进一步拓宽，向金融机构进行融资的能力增强，还款来源较为充足，具备清

偿债务的能力。

综上，公司实际控制人郑瑞俊、杨会夫妇资信状况良好，持有众多资产，还款资金来源较为充足，具备清偿债务的能力。

4、实际控制人大额负债对公司控制权稳定性的影响，是否会产生重大不利影响

公司实际控制人郑瑞俊、杨会有一些的经营积累及融资能力，财务状况良好。郑瑞俊、杨会夫妇现持有众多投资资产，可以通过资产处置变现、所投资公司分红以及借助相关资产通过金融机构进行融资等多种方式进行资金筹措，还款资金来源较为充足。

发行人实际控制人未就相关借款向债权人提供股份质押等担保措施，相关借款人与郑瑞俊之间不存在股份代持、利益输送及潜在利益安排，亦不存在其他实质性潜在担保措施、上市后担保安排或其他利益安排，不存在因未能按期偿还借款而被要求冻结、处置股份的风险。此外，黄明端等债权人已出具书面承诺，承诺自公司上市之日起三年内，均不会要求郑瑞俊归还相关借款或为相关借款提供担保。

综上所述，公司实际控制人大额负债不会对发行人控制权稳定性产生重大不利影响。

二、核查过程

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅截至报告期末实际控制人及其控制的企业关于对外负债的相关资金流水，了解发行人实际控制人对外负债情况；

2、取得实际控制人对外负债涉及的相关自然人出具的书面确认文件，查阅实际控制人对外负债相关的合同和相关凭证，了解实际控制人对外负债的形成过程、到期时间及偿还情况；

3、取得并查阅实际控制人个人信用报告和无犯罪记录证明，并通过中国裁

判文书网、中国执行信息公开网等网站进行网络检索，核查实际控制人的资信状况，核查其是否存在失信记录、重大诉讼或仲裁，所持公司股份是否存在诉讼或司法冻结等情形；

4、查阅实际控制人出具的调查表，并通过国家企业信用信息公示系统、企查查等网站进行网络检索，核查实际控制人投资资产情况；

5、查阅天虹科技公开披露资料，核查实际控制人投资资产的情况；

6、对实际控制人进行访谈，了解其对外负债的后续偿还资金安排及还款资金来源，核查其是否具备清偿能力。

三、核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人实际控制人大额负债主要用于支付前期股权转让款和员工持股平台出资款，发行人实际控制人还款资金来源较为充足，具备清偿债务的能力，发行人实际控制人大额负债不会对发行人控制权稳定性产生重大不利影响。

第二部分：发行人本次发行相关情况的更新

一、本次发行的批准和授权

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中论述了本次发行的批准和授权情况。截至本补充法律意见书出具日，发行人本次发行的批准和授权情况未发生变化。

2024年1月22日，上海证券交易所上市审核委员会召开2024年第4次上市审核委员会审议会议，对合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

本所律师认为，发行人已就本次发行获得了其内部有权机构的有效批准，本次发行尚需中国证监会同意注册。

二、发行人本次发行的主体资格

经核查，补充核查期间，发行人本次发行的主体资格未发生变化。

本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司；发行人股票已依法在上交所上市并持续交易；发行人不存在根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，具备进行本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

本所律师对照《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，对发行人本次发行应满足的实质条件进行逐项审查，结论如下：

（一）发行人本次发行符合《公司法》《证券法》规定的实质条件

1、经核查，发行人本次发行已经股东大会审议通过，并在公司债券募集办法中规定了具体的转换办法，本次发行尚需中国证监会同意注册，符合《公司法》第一百六十一条第一款的规定。

2、经核查，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十五条第一款第（一）项的规定。

3、根据《审计报告》，发行人 2021 年度、2022 年度、2023 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低）分别为 9,393.19 万元、12,618.17 万元及 16,819.47 万元。按照本次发行募集资金总额并参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平，发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）项的规定。

4、经核查，发行人本次发行筹集的资金，将按照《募集说明书》所列资金用途使用；如发行人改变资金用途，须经债券持有人会议作出决议。本次发行筹集的资金，未用于弥补亏损和非生产性支出，符合《证券法》第十五条第二款的规定。

5、经核查，本次发行为发行人首次向不特定对象发行可转换公司债券，不存在《证券法》第十七条规定的“（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态”或“（二）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途”等不得再次公开发行公司债券的情形，符合《证券法》第十七条的规定。

（二）发行人本次发行符合《注册管理办法》规定的实质条件

1、经核查，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（一）项的规定。

2、根据《审计报告》，发行人 2021 年度、2022 年度、2023 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低）分别为 9,393.19 万元、12,618.17 万元及 16,819.47 万元。按照本次发行募集资金总额并参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平，发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（二）项的规定。

3、经核查，截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末，发行人资产负债率分别为 31.62%、9.14%、12.91%，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 29,539.89 万元、60,114.17 万元和 35,145.96 万元。发行人具有合理的资产负债结

构和正常的现金流量，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（三）项的规定。

4、根据《注册管理办法》第十三条第二款的规定，发行人向不特定对象发行可转债，还应当遵守《注册管理办法》第九条第（二）项至第（五）项、第十条的规定：

（1）经核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求，符合《注册管理办法》第九条第（二）项的规定。

（2）经核查，发行人的资产独立完整，人员、财务、机构、业务均独立于发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形，符合《注册管理办法》第九条第（三）项的规定。

（3）经核查，发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《注册管理办法》第九条第（四）项的规定。

（4）经核查，发行人最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合《注册管理办法》第九条第（五）项的规定。

（5）经核查，发行人不存在《注册管理办法》第十条规定的下述情形：

1) 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

2) 发行人或者其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

3) 发行人或者其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形；

4) 发行人或者其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损害上

市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

（6）本次发行为发行人首次向不特定对象发行可转换公司债券，不存在《注册管理办法》第十四条规定的“（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态”或“（二）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途”等不得发行可转债的情形。

（7）发行人本次发行募集资金拟用于投资建设“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”、“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”及补充流动资金，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；本次募集资金未用于持有财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；募集的资金投资于科技创新领域的业务；未用于弥补亏损和非生产性支出，符合《注册管理办法》第十二条、第十五条的规定。

综上，本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的有关上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的实质条件。

四、发行人的设立

经核查，补充核查期间，发行人的设立情况未发生变化。

五、发行人的独立性

经核查，补充核查期间，发行人的独立性有关事项未发生变化。

六、发行人的主要股东及实际控制人

（一）发行人股本结构及前十大股东

1、根据中证登出具的权益登记日为 2023 年 12 月 31 日的《发行人股本结构表》，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人股本结构情况如下：

股份性质	数量（股）	比例（%）
限售条件流通股/非流通股	378,478,674	45.33
无限售条件流通股	456,374,607	54.67
总股本	834,853,281	100.00

2、根据中证登出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十大股东情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.3622	20.85
2	嘉兴高和	6,000.0000	7.19
3	汇成投资	3,771.6667	4.52
4	志道投资	2,430.0000	2.91
5	杨会	2,359.3934	2.83
6	Advance	2,000.0000	2.40
7	鼎祥基金	1,818.1818	2.18
8	蔚华电子	1,600.0000	1.92
9	安徽正奇资产管理有限公司	1,570.0000	1.88
10	Great Title	1,515.3889	1.82

（二）发行人的控股股东和实际控制人

1、控股股东

截至 2023 年 12 月 31 日，扬州新瑞连直接持有发行人 20.85% 的股份，为发行人的第一大股东，除扬州新瑞连外其他股东持股比例较为分散。

经核查，本所律师认为，扬州新瑞连为发行人的控股股东。

2、实际控制人

发行人实际控制人为郑瑞俊、杨会夫妇，截至 2023 年 12 月 31 日，郑瑞俊、杨会夫妇持股情况如下：

（1）郑瑞俊持有汇成投资 70% 的股份并担任其董事，汇成投资持有发行人 3,771.6667 万股股份，占发行人股本总额的 4.52%，因此郑瑞俊通过汇成投资间接控制发行人 4.52% 的股份；

（2）郑瑞俊担任发行人持股平台合肥芯成的执行事务合伙人，合肥芯成持有发行人 1,109.70 万股股份，占发行人股本总额的 1.33%，因此郑瑞俊通过合肥芯成间接控制发行人 1.33% 的股份；

（3）郑瑞俊持有发行人持股平台香港宝信 50.80% 的股份并担任其董事，其

他股东持股比例较为分散，香港宝信持有发行人 1,250.00 万股股份，占发行人股本总额的 1.50%，因此郑瑞俊通过香港宝信间接控制发行人 1.50% 的股份；

（4）杨会系郑瑞俊的配偶，杨会直接持有发行人 2,359.3934 万股股份，占发行人股本总额的 2.83%；

（5）杨会持有控股股东扬州新瑞连 70% 的财产份额并担任其执行事务合伙人，扬州新瑞连持有发行人 17,410.3622 万股股份，占发行人股本总额的 20.85%，因此杨会通过扬州新瑞连间接控制发行人 20.85% 的股份；

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，郑瑞俊、杨会夫妇合计共同控制发行人 31.02% 的股份，且自 2016 年 6 月至今，郑瑞俊一直担任汇成有限/发行人的董事长，并于 2020 年 9 月起至今担任发行人的总经理，对汇成有限/发行人的决策、日常经营及管理能够产生实质性影响。

经核查，本所律师认为，郑瑞俊、杨会为发行人的实际控制人。

（三）发行人持股 5% 以上股东所持股份的质押、冻结情况

根据中证登出具的《证券质押及司法冻结明细表》，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人持股 5% 以上股东所持股份不存在质押、冻结情形。

七、发行人的股本及演变

经核查，补充核查期间，发行人的股本及演变有关事项未发生变化。

八、发行人的业务

（一）发行人的经营范围和主营业务

经核查，发行人的主营业务为显示驱动芯片的先进封装测试服务，发行人全资子公司江苏汇成的主营业务为显示驱动芯片的金凸块制造及封装测试服务。补充核查期间，发行人及其子公司的经营范围和主营业务未发生变化，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）发行人及其子公司取得的与经营活动相关的资质和许可

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人及其子公司

取得的与经营活动相关的资质和许可。经核查，截至本补充法律意见书出具日，部分管理体系认证有效期发生变更，具体如下：

序号	公司	证书名称	编号	认证标准	适用产品或服务	有效期
1	汇成股份	质量管理体系认证	FM 772603	ISO 9001:2015	提供晶圆凸块制造、研磨、切割、封装及测试服务	2023.09.26-2026.09.25
2	汇成股份	职业健康安全管理体系认证	OHS 734174	ISO 45001:2018	提供晶圆凸块测试，研磨，切割，筛检与组装服务	2023.12.21-2026.12.20
3	江苏汇成	质量管理体系认证	FM 772604	ISO 9001:2015	提供晶圆凸块制造、研磨、切割、封装及测试服务	2023.09.26-2026.09.25
4	江苏汇成	职业健康安全管理体系认证	OHS 734174	ISO 45001:2018	提供晶圆凸块测试，研磨，切割，筛检与组装服务	2023.12.21-2026.12.20

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司已经取得了所从事业务必需的相关资质。

（三）发行人在中国大陆以外的经营情况

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人未在中国大陆之外设立经营主体开展经营活动。

（四）发行人的主营业务

根据《审计报告》，2021年度、2022年度及2023年度，发行人主营业务收入占营业收入的比例分别为96.26%、94.12%和94.36%，发行人主营业务突出。

（五）发行人持续经营

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形，其主要生产经营性资产不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，其经营所需的资质证书均在有效期内，不存在现行法律、法规禁止或限制发行人开展业务的情形，发行人不存在持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方

按照《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市规则》等对关联方的披露要求，截至本补充法律意见书出具日，发行人主要关联方及关联关系列示如下：

1、发行人的控股股东、实际控制人

截至本补充法律意见书出具日，发行人控股股东为扬州新瑞连，实际控制人为郑瑞俊、杨会。发行人控股股东、实际控制人的具体情况详见本补充法律意见书“六、发行人的主要股东及实际控制人”。

2、其他持有发行人 5% 以上股份的主体

截至本补充法律意见书出具日，除发行人的控股股东、实际控制人外，其他直接或间接持有发行人 5% 以上股份的主体如下：

序号	关联方	关联关系
1	纪念	通过扬州新瑞连间接持有发行人 6.26% 股份，系发行人董事沈建纬之子沈国威的配偶

3、控股股东、实际控制人控制或者由实际控制人担任董事、高级管理人员或施加重大影响的法人或其他组织

（1）截至本补充法律意见书出具日，发行人控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人或其他组织（发行人及其控股子公司除外）如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	汇成投资	郑瑞俊直接持股 70% 并担任董事
2	合肥芯成	郑瑞俊担任执行事务合伙人
3	合肥宝芯	郑瑞俊担任执行事务合伙人
4	合肥汇芯	郑瑞俊担任执行事务合伙人
5	香港宝信	郑瑞俊直接持股 50.80% 并担任董事
6	瑞成建筑	郑瑞俊直接持股 80% 并担任董事
8	百瑞发投资股份有限公司（注册于中国台湾）	郑瑞俊直接持股 50.96%，香港瑞仕持股 48.97%
9	瑞成投资控股有限公司（Ruicheng Investment Holding Limited，注册于中国香港）	郑瑞俊直接持股 70% 并担任董事

（2）截至本补充法律意见书出具之日，发行人实际控制人担任董事、高级管

理人员或施加重大影响的法人或其他组织（发行人及其控股子公司除外）如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	本溪瑞成房地产开发经营有限公司（已于 2001 年 6 月因逾期未年检被吊销，尚未注销）	郑瑞俊担任副董事长
2	海南巨东房地产开发有限公司（已于 1999 年 12 月因逾期未年检被吊销，尚未注销）	郑瑞俊担任副董事长

4、发行人的董事、监事和高级管理人员

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事、监事和高级管理人员如下：

序号	姓名	职务
1	郑瑞俊	董事长、总经理
2	沈建纬	董事
3	赵亚彬	董事
4	吴海龙	董事
5	杨辉	独立董事
6	程敏	独立董事
7	蔺智挺	独立董事
8	郭小鹏	监事会主席
9	陈殊凡	监事
10	程红艳	职工代表监事
11	林文浩	副总经理
12	钟玉玄	副总经理
13	马行天	副总经理
14	黄振芳	副总经理
15	奚颀	董事会秘书
16	闫柳	财务总监

5、关联自然人关系密切的家庭成员

截至本补充法律意见书出具日，上述第 1 项、第 2 项和第 4 项所述关联自然人关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）均为发行人关联方。

6、关联法人或关联自然人直接或者间接控制的、或者由关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

截至本补充法律意见书出具日，上述第 1-5 项所列关联法人（间接持有发行人 5% 以上股份的法人或其他组织除外）或关联自然人直接或者间接控制的、或

者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织（发行人及其控股子公司除外）均为发行人关联方。该等关联方（上文已披露的除外）主要包括：

序号	关联方	关联关系
1	香港瑞仕投资控股有限公司（Hong Kong Richest Investment Holdings Limited，注册于中国香港，以下简称“香港瑞仕”）	郑瑞俊之子直接持股 100% 并担任董事
2	志道投资	赵亚彬担任董事、总经理的企业，报告期内曾持有发行人 5% 以上的股份
3	武汉正奇志道投资有限公司	赵亚彬担任执行董事、总经理的企业，志道投资持股 100%
4	合肥质然房地产开发有限公司	赵亚彬担任董事
5	广东惠伦晶体科技股份有限公司	赵亚彬担任董事
6	正奇（上海）股权投资管理有限公司	赵亚彬担任董事、总经理
7	安徽正奇资产管理有限公司	赵亚彬担任董事、总经理
8	安徽大湖诚文化传媒有限公司	赵亚彬持股 45%，为第一大股东
9	合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司	吴海龙担任董事
10	安徽易芯半导体有限公司	吴海龙担任董事
11	合肥北航通航产业技术有限公司	吴海龙担任董事
12	合肥市科创集团有限公司	吴海龙担任董事
13	合肥市创业投资引导基金有限公司	吴海龙担任董事
14	合肥工投智聚股权投资有限公司	吴海龙担任执行董事、总经理
15	科大硅谷服务平台（安徽）有限公司	吴海龙担任董事长、总经理
16	合肥市场景应用创新促进中心有限公司	吴海龙担任董事长
17	合肥德丰杰雷名创业投资企业	吴海龙担任法定代表人的企业
18	北京华拓云智科技有限公司	蔺智挺配偶的哥哥姜金竹持股 80%，并担任执行董事、经理
19	苏州麦种科技有限公司	蔺智挺持股 51%，并担任总经理
20	合肥存算体企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	蔺智挺担任执行事务合伙人
21	艾科微电子（深圳）有限公司	马行天的弟弟马行健担任董事
22	苏州格兰科医药科技有限公司	陈殊凡担任董事
23	安徽恒言一信息科技有限公司	闫柳妹妹的配偶衡威威持股 100%，并担任执行董事、总经理
24	上海携益信息技术有限公司	郭小鹏担任执行董事
25	南京邦盛投资管理有限公司	郭小鹏担任董事
26	浩德科技股份有限公司	郭小鹏担任董事
27	成都万创科技股份有限公司	郭小鹏担任董事
28	南京博兰得电子科技有限公司	郭小鹏担任董事
29	江苏华中气体有限公司	郭小鹏担任董事
30	南京典格通信科技有限公司	郭小鹏担任董事

7、发行人的子公司、联营企业、合营企业

截至本补充法律意见书出具日，发行人的子公司、联营企业、合营企业具体

情况如下：

序号	公司名称	关联关系
1	江苏汇成	子公司
2	晶汇聚芯	发行人直接持有 14.20%财产份额的企业
3	晶合汇信	发行人直接持有 13.00%股权的企业

8、其他关联方

除上述已披露关联方之外，发行人的关联方还包括根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织，以及在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人（视同发行人的关联方）。该等主要关联方的情况如下：

序号	关联方	关联关系	报告期内是否存在交易
1	萧明山	报告期内离任董事、总经理（2020 年 9 月离任）	否
2	袁飞	报告期内离任董事（2021 年 3 月离任）	否
3	杨毅梅	报告期内离任监事（2021 年 3 月离任）	否
4	Tieer Gu（顾铁）	报告期内离任独立董事（2021 年 6 月离任）	否
5	施周峰	报告期内离任财务总监、董事会秘书（2022 年 11 月离任）	否
6	赵志清	报告期内离任监事（2023 年 5 月离任）	否
7	杨欢	报告期内离任监事（2023 年 11 月离任）	否
8	童富	报告期内童富及其关系密切的家庭成员曾通过 Great Title 间接持有发行人 5% 以上股份	否
9	陈玉琴	报告期内陈玉琴及其关系密切的家庭成员曾通过 Advance 间接持有汇成有限 5% 以上股权	否
10	张兆文	陈玉琴配偶	否
11	上海泰菱金属制品有限公司	张兆文控制的公司	否
12	正奇控股	持有志道投资 100% 股权，报告期内曾通过志道投资间接持有发行人 5% 以上股份	否
13	联想控股股份有限公司	持有正奇控股 94.62% 股权，报告期内曾通过正奇控股间接持有发行人 5% 以上股份	否
14	珠海市横琴惟诚投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 90.13% 合伙份额，已于 2023 年 10 月 18 日注销	否
15	安徽嘉润金地企业管理有限公司	志道投资持股 100%	否
16	合肥泰兴商业运营管理有限公司	安徽嘉润金地企业管理有限公司持股 100%	否

17	铜陵志道商业运营管理有限公司	安徽嘉润金地企业管理有限公司持股 100%	否
18	铜陵惟道商业运营管理有限公司	安徽嘉润金地企业管理有限公司持股 100%	否
19	正奇光能科技有限公司	志道投资持股 45%，武汉正奇志道投资有限公司持股 40%	否
20	安徽惟本投资中心（有限合伙）	志道投资曾担任执行事务合伙人并持有 99.12% 合伙份额，已于 2023 年 11 月退出并离任执行事务合伙人	否
21	安徽正乾股权投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 5% 合伙份额	否
22	安徽惟道投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 94.17% 合伙份额，已于 2023 年 12 月 15 日注销	否
23	安徽正臻创业投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1% 合伙份额	否
24	天津正奇壹号产业投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1% 合伙份额	否
25	哈尔滨祥冠股权投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1% 合伙份额	否
26	厦门正奇腾飞一期股权投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 0.99% 合伙份额	否
27	天津原力正奇产业投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1% 合伙份额	否
28	天津正奇凯旋一期新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1% 合伙份额	否
29	安徽志飞股权投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 30% 合伙份额	否
30	嘉兴弘道股权投资基金合伙企业（有限合伙）	志道投资为执行事务合伙人，并持有 6.67% 合伙份额的企业，已于 2021 年 5 月注销	否
31	珠海市横琴惟信股权投资合伙企业（有限合伙）	志道投资为执行事务合伙人，并持有 5% 合伙份额的企业，已于 2021 年 4 月注销	否
32	安徽正坤创业投资中心（有限合伙）	志道投资为执行事务合伙人，已于 2021 年 10 月注销	否
33	合肥雪祺电气股份有限公司	赵亚彬曾任该公司董事，已于 2021 年 4 月离任	否
34	安徽统唯新材料科技股份有限公司	赵亚彬曾任该公司董事，已于 2021 年 4 月离任	否
35	浙江祥邦科技股份有限公司	赵亚彬曾任该公司董事，已于 2021 年 6 月离任	否
36	合肥工大高科信息科技股份有限公司	赵亚彬曾任该公司董事，已于 2021 年 9 月离任	否
37	一拓通信集团股份有限公司	赵亚彬曾任该公司董事，已于 2021 年 8 月离任	否
38	安徽九华山旅游发展股份有限公司	赵亚彬曾任该公司董事，已于 2022 年 4 月离任	否
39	西藏志道企业管理有限公司	赵亚彬曾任该公司董事长、总经理，已于 2022 年 2 月注销	否
40	安徽新华国金小额贷款	发行人董事赵亚彬曾担任总经理，已于 2023 年 11	否

	有限公司	月 7 日离任	
41	合肥新站众智创业投资有限公司	吴海龙曾任该公司董事，已于 2021 年 11 月注销	否
42	安徽省信息产业投资控股有限公司	吴海龙曾任该公司董事，已于 2022 年 5 月离任	否
43	合肥市东芯信息技术有限公司	吴海龙曾任该公司董事，已于 2023 年 3 月离任董事并担任监事，并已于 2023 年 11 月离任监事	否
44	合肥产投资本创业投资管理服务有限公司	吴海龙曾任该公司董事、副总经理，已于 2022 年 1 月离任董事，于 2022 年 12 月离任副总经理	否
45	合肥市新站产业投资有限公司	吴海龙曾任该公司董事长，已于 2023 年 7 月离任	否
46	合肥产投国正股权投资有限公司	吴海龙曾任该公司董事，已于 2023 年 7 月离任	是
47	上海剑桥科技股份有限公司	郭小鹏曾担任董事，已于 2021 年 7 月 4 日离任	否
48	江苏建金科技发展有限公司	郭小鹏曾担任董事，已于 2021 年 11 月 9 日离任	否
49	江苏斑马软件技术有限公司	郭小鹏曾担任董事，已于 2022 年 7 月 19 日离任	否
50	江苏千米网络科技有限公司	郭小鹏曾担任董事，已于 2024 年 3 月 19 日离任	否
51	江苏奇纳新材料科技有限公司	郭小鹏曾担任董事，已于 2024 年 4 月 15 日离任	否
52	海口三立现代办公设备有限公司	郑瑞俊曾实际控制的企业，已于 2021 年 11 月注销	否
53	江苏越莱萤环保科技有限公司	杨会曾持股 50% 的企业，已于 2021 年 11 月注销	否
54	杨绍校	报告期内曾持有发行人 5% 以上股份	否
55	嘉兴高和	报告期内曾持有发行人 5% 以上股份，杨绍校为执行事务合伙人	否
56	浙江红太阳毛纺织有限公司	杨绍校担任执行董事	否
57	顺木供应链（浙江）有限公司	杨绍校担任执行董事	否
58	浙江茂森置业有限公司	杨绍校持股 10% 并担任董事	否
59	Deep Blue International Investment Holding Ltd.	杨绍校持股 100% 并担任董事	否
60	品德国际投资控股（香港）有限公司	杨绍校持股 100% 并担任董事	否
61	浙江高和羊毛科技有限公司	品德国际投资控股（香港）有限公司曾持股 100%	否
62	浙江扳鞍实业发展有限公司（以下简称“扳鞍实业”）	嘉兴高和持股 99.61%，杨绍校持股 0.39%	否
63	珠海扳鞍资产管理有限公司	扳鞍实业持股 100%	否
64	扳鞍智慧供应链（嘉兴）有限公司（以下简称“扳鞍供应链”）	扳鞍实业持股 100%	否
65	扳鞍羊毛工业（嘉兴综	扳鞍供应链持股 100%	否

	合保税区)有限公司		
66	浙江阳光普泽融资担保有限公司	扳鞍实业持股 82%，已于 2023 年 10 月 10 日注销	否
67	桐乡市民间融资服务中心有限公司	扳鞍实业持股 70%	否
68	浙江扳鞍资产管理有限公司	嘉兴高和持股 83%，杨绍校持股 17%	否
69	沈阳云智科技有限公司	发行人独立董事蔺智挺配偶的哥哥姜金竹曾持股 57%并担任执行董事，已于 2024 年 2 月退出持股并离任执行董事	否

（二）发行人与关联方之间的关联交易

根据《审计报告》并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人报告期内的关联交易情况如下：

1、关联担保情况

（1）借款（含保理、融资租赁）担保

报告期内，发行人及其子公司因借款（含保理、融资租赁）发生的关联担保及截至本补充法律意见书出具之日的履行情况如下：

①报告期内汇成股份作为被担保方的关联担保

序号	债权人	担保方/反担保方	主债权金额 (万元)	主债权期限	担保/反担保方式	是否履行完毕
1	中国建设银行股份有限公司龙门支行	扬州新瑞连	6,800.00	2017.09.22-2021.12.15	为担保人合肥鑫城提供股权质押反担保	是
		郑瑞俊			为担保人合肥鑫城提供连带责任保证反担保	
		扬州新瑞连	8,200.00	2018.09.29-2021.12.15	为担保人合肥鑫城提供股权质押反担保	是
2	中国建设银行股份有限公司合肥城东支行	郑瑞俊、杨会、瑞成建筑、安徽创新融资担保有限公司 ^(注1)	7,000.00	2020.05.28-2022.06.01	为担保人合肥市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保	是
		郑瑞俊、杨会、瑞成建筑			为反担保人安徽创新融资担保有限公司提供连带责任保证反担保	是
3	东莞银行股份有限公司合肥分行	郑瑞俊	最高额 8,060.00	主债权发生期间 2019.07.03-	最高额连带责任保证	否

				2025.07.02		
4	合肥产投国正股权投资有限公司（委托华夏银行股份有限公司合肥高新区支行贷款）	郑瑞俊、杨会、扬州新瑞连、瑞成建筑	1,000.00	2020.01.21-2021.01.21	连带责任保证	是
			3,000.00	2020.04.30-2021.04.30	连带责任保证	是
			4,000.00	2020.06.10-2021.06.01	连带责任保证	是
			1,000.00	2021.02.26-2022.02.11	连带责任保证	是
			3,000.00	2021.05.10-2022.05.10	连带责任保证	是
			4,000.00	2021.06.21-2022.06.21	连带责任保证	是
5	合肥兴泰商业保理有限公司	郑瑞俊、杨会	保理总额度 2,000.00	额度有效期 2020.09.18-2021.09.17	连带责任保证	是
6	合肥兴泰科技融资租赁有限公司	郑瑞俊、杨会	4,500.00	2019.02.01-2021.07.02	以个人名下房产提供抵押担保； 连带责任保证	是
7	中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行	郑瑞俊、杨会	最高额 10,000.00	主债权发生期间 2021.05.06-2022.05.05	最高额连带责任保证（担保债权最高额为10,000.00万元）	是
			15,000.00	2021.12.21-2022.08.25		是
8	招商银行股份有限公司合肥分行	郑瑞俊、杨会	最高额 10,000.00	主债权发生期间 2021.03.29-2022.03.28	最高额连带责任保证	是
		郑瑞俊	最高额 15,000.00	主债权发生期间 2022.02.28-2023.08.15 ^{（注2）}	最高额连带责任保证	是
		杨会	最高额 15,000.00			是
9	华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	郑瑞俊、杨会	最高额 10,000.00	主债权发生期间 2021.05.17-2022.05.17	以个人名下房产提供抵押担保	是
				主债权发生期间 2021.05.17-2022.11.19 ^{（注3）}	最高额连带责任保证	是
10	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	郑瑞俊、杨会	最高额 4,000.00	主债权发生期间 2021.05.24-2022.04.29	最高额连带责任保证	是
11	兴业银行股份有限公司合肥支行	郑瑞俊	最高额 6,000.00 ^{（注4）}	主债权发生期间 2021.10.19-2022.10.19	最高额连带责任保证	是
		杨会	最高额 6,000.00 ^{（注4）}	主债权发生期间 2021.10.20-2022.10.20		是
12	杭州银行股份有限公司合肥瑶海支行	郑瑞俊	最高额 11,000.00	主债权发生期间 2022.02.21-2023.08.15	最高额连带责任保证	是
		杨会	最高额 11,000.00			是
13	中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行	郑瑞俊、杨会	最高额 4,800.00	主债权发生期间 2022.06.13-2023.08.21	最高额连带责任保证	是

注 1：安徽创新融资担保有限公司系志道投资的关联公司。

注 2：根据保证合同的相关约定，编号为 551XY2021007941 的《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额部分转入本项担保的被担保主债权范围。

注 3：根据保证合同的相关约定，编号为 HF11（高融）20210002 的《最高额融资合同》和编号为 HF11（高融）20210002-补 1 的《补充协议》项下债权转入本项担保的被担保主债权范围，前述主债权发生期间为 2021 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 17 日。

注 4：根据保证合同的相关约定，2021 年 3 月 23 日公司与债权人签署的，编号为 215302 保 007 的《开立银行保函协议》的相关债权也属于该项担保的被担保主债权。

注 5：截至 2023 年 12 月 31 日，上表中尚未履行完毕的担保合同项下均无正在履行的借款。

②报告期内江苏汇成作为被担保方的关联担保

序号	债权人	担保方	被担保最高债权额（万元）	主债权发生期间	担保方式	是否履行完毕
1	江苏银行股份有限公司扬州分行	郑瑞俊	4,000.00	2019.05.07-2021.09.07	最高额连带责任保证	是
		郑瑞俊、杨会	5,000.00	2021.09.08-2024.07.22	最高额连带责任保证	否
2	中信银行股份有限公司扬州分行	郑瑞俊	3,000.00	2018.04.19-2021.04.19	最高额连带责任保证	是
3	中国银行股份有限公司扬州邗江支行	郑瑞俊	3,500.00	2018.06.22-2023.06.21 ^(注1)	最高额连带责任保证	是
		瑞成建筑	3,500.00	2021.06.01-2023.08.07 ^(注2)	最高额连带责任保证	是
4	正奇国际商业保理有限公司	郑瑞俊、杨会	3,000.00	额度有效期 2020.07.30-2021.01.30	连带责任保证	是
5	招商银行股份有限公司扬州分行	郑瑞俊、杨会	3,000.00	2021.09.26-2022.09.25	最高额连带责任保证	是

注 1：根据保证合同的相关约定，在 2018 年 6 月 22 日前债务人与债权人之间实际发生的债权也属于该项担保的被担保主债权。

注 2：根据保证合同的相关约定，在 2021 年 6 月 1 日前债务人与债权人之间实际发生的债权也属于该项担保的被担保主债权。

注 3：截至 2023 年 12 月 31 日，上表中尚未履行完毕的担保合同项下均无正在履行的借款。

（2）其他担保

2018 年 10 月，扬州新瑞连与合肥创投签署股权转让协议，约定合肥创投将其持有的汇成有限 16.93% 股权（对应出资额 6,800 万元）转让给扬州新瑞连，股权转让价格为合肥创投取得该等股权时对应的投资款 17,000 万元附加相应的利息，股权转让款项分期支付。汇成有限为扬州新瑞连在协议项下应履行的全部义务及承担的违约责任（包括但不限于标的股权转让款、违约金的支付以及债权实现费用等）提供不可撤销的无限连带责任保证。各方于 2021 年 9 月签署《股权转让协议之补充协议（二）》，该连带担保责任于该协议生效之日起终止。

2、关联方资金拆入

拆出方	期初数 (万元)	本期拆入 (万元)	本期应计 利息 (万元)	本期减少 (万元)	本期豁免 利息 (万元)	期末数 (万元)	说明
2021 年度							
扬州新瑞连	1,182.85	1,500.00	45.52	2,682.85	45.52	-	注 1
瑞成建筑	1,000.00	-	32.17	1,000.00	32.17	-	注 1
合计	2,182.85	1,500.00	77.68	3,682.85	77.68	-	-

注 1：豁免的拆借款利息计入资本公积。

公司上述资金拆借已经于 2021 年 7 月全部归还。

3、关键管理人员报酬

名称	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额 (万元)	占营业 成本比 例	金额 (万元)	占营业 成本比 例	金额 (万元)	占营业成本 比例
关键管理人员报酬	747.83	0.82%	599.23	0.89%	465.13	0.83%

注 1：公司股改后聘任的关键管理人员报酬在报告期内连续计算。

注 2：公司前财务总监、董事会秘书施周峰任期自 2021 年 3 月开始，至 2022 年 11 月离职；现财务总监闫柳任期为 2022 年 12 月至 2024 年 3 月，2022 年度关键管理人员薪酬包含上述两人 2022 年度自公司获得的全年税前报酬总额；

注 3：公司现董事会秘书奚懿任期为 2023 年 4 月至 2024 年 3 月，副总经理黄振芳任期为 2023 年 5 月至 2024 年 3 月，前任监事赵志清于 2023 年 5 月离任，2023 年度关键管理人员薪酬包含上述三人 2023 年度自公司获得的税前报酬总额。

4、其他关联交易

报告期内，合肥产投国正股权投资有限公司通过委托贷款方式向发行人提供借款，具体情况如下：

委托方	贷款银行	借款年度	贷款金额（万元）
合肥产投国正股权投资有限公司	华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	2021 年度	8,000.00
合计			8,000.00

公司出于日常经营资金需求与合肥产投国正股权投资有限公司签订委托贷款合同，合肥产投国正股权投资有限公司通过委托贷款方式向本公司提供借款，上述借款均已归还。

5、比照关联交易披露的交易

（1）交易对方情况

序号	交易对方姓名或名称	与发行人关系
1	蔚华电子	公司持股 5% 以下股东
2	Spirox Cayman Corporation	股东蔚华电子的母公司
3	蔚华科技股份有限公司	Spirox Cayman Corporation 的母公司
4	蔚华国际有限公司	股东蔚华电子的关联公司
5	天虹科技股份有限公司	实际控制人郑瑞俊直接持股 7.10%，其控制的百瑞发投资股份有限公司持股 6.40%
6	鑫天虹（厦门）科技有限公司（以下简称“鑫天虹”）	天虹科技的全资子公司
7	传晶电子（上海）有限公司	鑫天虹全资子公司
8	Strong Lion	公司持股 5% 以下股东
9	安徽创新融资担保有限公司	股东志道投资的关联公司

（2）采购商品

交易对方名称	交易内容	2023 年度 （万元）	2022 年度 （万元）	2021 年度 （万元）
蔚华	设备	429.37	2,978.27	2,367.37
天虹	材料及费用	-	24.93	33.53
合计	-	429.37	3,003.20	2,400.90

注：上表中，按照同一控制下合并口径披露，蔚华包括蔚华科技股份有限公司、蔚华电子和蔚华国际有限公司；天虹包括天虹科技股份有限公司、鑫天虹（厦门）科技有限公司和传晶电子（上海）有限公司。

蔚华科技股份有限公司系中国台湾上市公司，系专业集成电路设备代理商。报告期内，受限于全球及中国集成电路行业的发展情况，公司直接向境外的集成电路设备厂商购置设备需有较长的交期，蔚华科技股份有限公司作为专业的集成电路设备代理商，拥有丰富的集成电路设备渠道资源，可提高公司的设备采购效率。上述交易价格系双方根据市场公允价格协商确定。

天虹科技股份有限公司、鑫天虹（厦门）科技有限公司系集成电路设备制造商。报告期内，公司曾向天虹科技股份有限公司、鑫天虹（厦门）科技有限公司采购零星配件等。上述采购价格系双方根据市场公允价格协商确定。

（3）比照关联方资金拆入

拆借单位名称/ 自然人姓名	期初数 （万元）	本期 拆入	本期应 计利息	本期减少 （万元）	本期豁 免利息	期末 数	说 明
------------------	-------------	----------	------------	--------------	------------	---------	--------

		(万元)	(万元)		(万元)		
2021 年度							
Spirox Cayman Corporation	99.81	-	-	99.81	-	-	-
Strong Lion	35.62	-	-	35.62	-	-	-
合计	135.43	-	-	135.43	-	-	-

（4）融资担保

报告期内，安徽创新融资担保有限公司为发行人取得银行借款提供融资担保。2021 年度，公司向安徽创新融资担保有限公司支付了融资担保手续费 140.00 万元。

经核查，发行人在报告期内的关联交易经过了发行人董事会或股东大会的确认，关联董事或股东在审议相关交易时已回避表决，独立董事对关联交易发表了意见并对关联交易的公允性进行了确认，关联交易公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

（三）控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺

为规范和减少发行人的关联交易，发行人控股股东扬州新瑞连、实际控制人郑瑞俊、杨会于首次公开发行股票时作出了相关承诺，具体详见《律师工作报告》“九、关联交易及同业竞争”之“（三）控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺”。

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人控股股东、实际控制人不存在违反上述承诺的情形。

（四）经核查，本次募投项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增显失公平的关联交易。

（五）关联交易程序规定

经核查，公司已建立了完善的公司治理制度，并在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等公司治理制度中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等，明确了关联交易公允决策程序，其内容合法有效。

（六）同业竞争

1、发行人与控股股东、实际控制人控制的企业之间不存在同业竞争情形

经核查，发行人的控股股东、实际控制人及其控制的除纳入发行人合并报表范围内的其他企业目前均没有从事与发行人相同或相似的业务。

2、为避免发生同业竞争，控股股东扬州新瑞连及实际控制人郑瑞俊、杨会于首次公开发行股票时作出了相关承诺，具体详见《律师工作报告》“九、关联交易及同业竞争”之“（五）同业竞争”。

经核查，发行人控股股东、实际控制人已采取有效措施避免同业竞争，不存在违反上述承诺的情形，未损害发行人利益。

3、经核查，本次募投项目实施主体为发行人或其全资子公司，实施后不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争。

（七）发行人关于报告期内重大关联交易及同业竞争的披露情况

经核查，发行人已在《募集说明书》及其他本次发行的申请文件中就报告期内发生的重大关联交易和同业竞争情况进行了充分的披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

（一）土地使用权

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人及其子公司拥有的土地使用权。经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司新拥有土地使用权 1 处，部分土地使用权已抵押，具体情况如下：

序号	权利人	证书编号	坐落	用途	面积(m ²)	使用期限至	权利受限情形
1	汇成股份	皖（2024）合肥市不动产权第1033192号	新站区铜陵北路与项王东路交口西北角	工业用地	38,006.34	2074.01.11	无
2	江苏汇成	扬邗国用（2012）第	扬州市邗江经	工业用地	39,821.00	2062.07.30	已抵押

		2012004 号	济开 发 区 南 园				
--	--	-----------	------------------------	--	--	--	--

（二）房屋所有权

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人及其子公司拥有的房屋所有权。经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司拥有的部分房屋所有权已抵押，具体情况如下：

序号	权利人	证书编号	坐落	用途	房屋建筑 面积 (m ²)	权利受 限情形	
1	江苏 汇成	扬房权证邗江 字第 20120153 90号	邗江区兴农路 1 号	1 幢	厂房	5,678.44	已抵押
				2 幢	厂房	19,640.56	
				3 幢	动力楼	3,454.95	
				4 幢	仓库	590.49	
				5 幢	门卫	127.70	

（三）租赁房产

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司租赁房产情况如下：

序号	承租 人	出租人	承租房产坐落	租赁期限	面积 (m ²)	是否 备案
1	汇 成 股 份	合 肥 市 住 房 租 赁 发 展 股 份 有 限 公 司	合肥市新站区龙子湖路 369号平板显示基地公租房 8#706、709、710、810、902、 904、906、907、908 室	2024.01.01- 2024.12.31	366.69	是
2			合肥市新站区龙子湖路 369号平板显示基地公租房 8#1001、1004、1005、1008、 1009、1010 室	2024.01.23- 2025.01.22	244.46	是
3			新站区龙子湖路 369 号平板 显示基地公租房 8#1007、 1101、1102、1103、1104、 1105、1106、1107、1108、 1109、1201、1202、1208 室	2024.02.27- 2025.02.26	561.13	是
5			合肥市新站区龙子湖路 369 号平板显示基地公租房 8#705、707、708、805、807、 808 室	2023.05.18- 2024.05.17	263.34	是
6			合肥市新站区龙子湖路 369 号平板显示基地公租房 8#701-704、901、905 室	2023.04.18- 2024.05.17	263.34	是
7			新站区龙子湖路 369 号平板	2024.01.25-	438.90	是

			显示基地公租房 8#802、1306、1901-1903、2001-2003、2006、2008 室	2025.01.24		
8	合肥鑫城		新站区平板基地公租房（66 间）	2021.09.01-2024.08.31	3,402.34	是
9			新站区平板基地公租房（30 间）	2021.12.01-2024.11.30	1,260.06	是
11	合肥蓝科投资有限公司		合肥综合保税区仓库厂房一期项目房屋 G 幢二层 201 室	2023.09.10-2024.09.09	2,551.25	否
12			合肥综合保税区仓库厂房一期项目房屋 G 幢一层 101 室	2024.01.02-2025.01.01	2,241.76	否
13	江苏汇成	扬州高新技术产业开发区管理委员会	扬州高新区南园生活配套区“青年公寓”二期 13 号公寓 201-216、301-316	2024.04.15-2025.04.14	1,760.00	是
14			扬州高新区南园生活配套区青年路 3 号（青年公寓）13 幢 4 层、5 层	2023.07.01-2024.06.30	1,718.90	是
15			扬州高新区南园生活配套区“青年公寓”二期 13 号公寓 601-610	2024.01.01-2024.12.31	550.00	是

（四）注册商标

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司拥有的注册商标未发生变化。

（五）已授权专利

根据发行人提供的专利权证书并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司新取得专利权 55 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 45 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请时间	取得方式	他项权利
1	半导体芯片封装用点胶设备	汇成股份	发明专利	ZL202211175520.7	2022.09.26	原始取得	无
2	一种金凸块表面粗糙度改善方法	汇成股份	发明专利	ZL202111062370.4	2021.09.10	原始取得	无
3	一种卷带式封装设备用料带可视镜	汇成股份	实用新型	ZL202321441205.4	2023.06.07	原始取得	无
4	涂胶前轨道风刀	汇成股份	实用新型	ZL202322078322.5	2023.08.03	原始取得	无

5	一种改造后的轨道支撑弧	汇成股份	实用新型	ZL202322121466.4	2023.08.08	原始取得	无
6	一种便于更换内环 o-ring 装置	汇成股份	实用新型	ZL202322619040.1	2023.09.25	原始取得	无
7	一种胶管存储放置架	汇成股份	实用新型	ZL202322741041.3	2023.10.11	原始取得	无
8	一种高精密辅助分析捲带式驱动 IC 的装置	江苏汇成	发明专利	ZL202111540839.0	2021.12.16	原始取得	无
9	卷绕机台保护带传输导轨装置	江苏汇成	发明专利	ZL202111540989.1	2021.12.16	原始取得	无
10	一种合框机滑行盖固定装置	江苏汇成	发明专利	ZL202111534416.8	2021.12.15	原始取得	无
11	一种 UV 机晶圆铁框定位装置	江苏汇成	发明专利	ZL202011549660.7	2020.12.24	原始取得	无
12	一种硅片封装结构及其制备方法	江苏汇成	发明专利	ZL201910131730.8	2019.02.22	原始取得	无
13	一种螺旋式光阻涂布结构及其制备装置与方法	江苏汇成	发明专利	ZL201910125864.9	2019.02.20	原始取得	无
14	一种晶圆贴底膜装置	江苏汇成	发明专利	ZL201910022232.X	2019.01.10	原始取得	无
15	一种自动化晶圆转移装置	江苏汇成	发明专利	ZL201811492067.6	2018.12.07	原始取得	无
16	一种 OVEN 机台控制面板防误触装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320718626.0	2023.04.04	原始取得	无
17	一种读取及播报机台异常报警代码装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320704277.7	2023.04.03	原始取得	无
18	一种切割后晶圆包装盒	江苏汇成	实用新型	ZL202320685181.0	2023.03.31	原始取得	无
19	一种可调节式离子枪安装支架	江苏汇成	实用新型	ZL202320668365.6	2023.03.30	原始取得	无
20	一种涂覆涂胶轴颗粒防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320668355.2	2023.03.30	原始取得	无
21	一种防打滑的卷绕机轴心刹车装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320589247.6	2023.03.23	原始取得	无
22	一种防晶圆污染显微镜挡板	江苏汇成	实用新型	ZL202320393379.1	2023.03.06	原始取得	无
23	一种用于 load port 的排风装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320353384.	2023.03.01	原始取得	无

				X			
24	一款 FT 测试机台冲裁不良品的计数器治具	江苏汇成	实用新型	ZL202320353388.8	2023.03.01	原始取得	无
25	一种光阻涂布机械手晶圆防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320323260.7	2023.02.27	原始取得	无
26	一种显微镜遮光组件	江苏汇成	实用新型	ZL202320323108.9	2023.02.27	原始取得	无
27	一种判断 COF 产品品质的显示装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320068238.2	2023.01.10	原始取得	无
28	一种石英舟运输专用防震车	江苏汇成	实用新型	ZL202321175157.9	2023.05.16	原始取得	无
29	一种防真空掉落保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321139803.6	2023.05.12	原始取得	无
30	一种内引脚接合机网状式加强型挡板	江苏汇成	实用新型	ZL202321139805.5	2023.05.12	原始取得	无
31	一种离子风扇安装固定装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321242441.3	2023.05.22	原始取得	无
32	一种用于涂胶机前置清针装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321628739.8	2023.06.26	原始取得	无
33	一种新型锁紧装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321628730.7	2023.06.26	原始取得	无
34	一种 12 寸晶圆专用推车	江苏汇成	实用新型	ZL202321662581.6	2023.06.28	原始取得	无
35	一种 ESD 防护卷带货架	江苏汇成	实用新型	ZL202321662606.2	2023.06.28	原始取得	无
36	一种防止料盘宽度用错装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321855040.5	2023.07.14	原始取得	无
37	一种 AVI 机台张力轮防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321855035.4	2023.07.14	原始取得	无
38	一种保护带张力调节装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321872275.5	2023.07.17	原始取得	无
39	一种限制测试机台显微镜载台高度的装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322009387.4	2023.07.28	原始取得	无
40	一种防止 INK 笔泼墨的装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322228723.4	2023.08.18	原始取得	无
41	一种马达轴心防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321872281.0	2023.07.17	原始取得	无
42	一种摄像头安装固定装置	江苏	实用	ZL20232	2023.	原始	无

		汇成	新型	2009376.6	07.28	取得	
43	一种电浆机台显示器及鼠标固定装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322189568.X	2023.08.15	原始取得	无
44	一种油墨机台线圈笔架保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322258863.6	2023.08.22	原始取得	无
45	一种COF料带紧密型放置搁架	江苏汇成	实用新型	ZL202322258846.2	2023.08.22	原始取得	无
46	一种OVEN机台电源开关防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320668358.6	2023.03.30	原始取得	无
47	一种具备连接插头快速控制开关的点墨机台	江苏汇成	实用新型	ZL202322146524.9	2023.08.10	原始取得	无
48	一种电浆机台晶圆收纳盒保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322189598.0	2023.08.15	原始取得	无
49	一种用于INK笔开封的装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322228703.7	2023.08.18	原始取得	无
50	一种可调节的防止INK笔刮伤晶圆表面的装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322356459.2	2023.08.31	原始取得	无
51	一种IC拾取承接装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322371853.3	2023.09.01	原始取得	无
52	一种晶舟盒氮气柜流量计保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322416133.4	2023.09.06	原始取得	无
53	一种配备有外挂计时蜂鸣器的烘干烤箱	江苏汇成	实用新型	ZL202322416123.0	2023.09.06	原始取得	无
54	一种晶圆溅镀定位治具	江苏汇成	实用新型	ZL202322428452.7	2023.09.07	原始取得	无
55	一种取标头存放装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322498833.2	2023.09.14	原始取得	无

报告期内，发行人子公司因专利保护期届满而失效的专利有2项，均为实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请时间	取得方式	他项权利
1	覆晶芯片与柔性电路板间的封胶前除尘装置	江苏汇成	实用新型	ZL201420008413.X	2014.01.07	原始取得	无
2	COF覆晶结合前柔性电路板及芯片表面微尘清除器	江苏汇成	实用新型	ZL201420008630.9	2014.01.07	原始取得	无

（六）软件著作权

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司拥有的软件著作权未发生变化。

（七）主要生产经营设备

根据《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人通用设备账面价值 839.83 万元，专用设备账面价值 211,226.02 万元，运输工具账面价值 150.33 万元。

（八）在建工程

根据《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人在建工程账面价值为 18,068.39 万元，主要为生产机器设备。

（九）子公司

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人的子公司。经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人全资子公司情况未发生变化，新增 2 家参股合伙企业/公司，具体情况如下：

序号	参股合伙企业/公司	出资额/注册资本 (万元)	持股情况
1	晶汇聚芯	35,200.00	汇成股份持有 14.20%财产份额
2	晶合汇信	1,000.00	汇成股份持有 13.00%股权

十一、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

1、销售合同

报告期内，发行人及其子公司与主要客户通过签署框架合同的方式建立业务合作关系，并通过订单方式交易，客户根据需求下单，发行人及其子公司根据客户订单组织生产。发行人及其子公司与报告期内前五大客户签署的已履行完毕和正在履行的重要框架合同如下：

序号	合同对方	合同有效期	合同服务内容	签订主体	是否履行完毕
1	天钰科技股份有限公司	2018.06.25-2021.06.24	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是
		2018.06.25-2021.06.24	显示驱动芯片	江苏	是

			封装测试	汇成	
		2021.07.05-长期	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否
		2021.07.05-长期	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否
		2021.07.05-长期	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否
		2021.07.05-长期	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	否
		2021.07.05-长期	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	否
		2021.07.05-长期	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	否
	深圳天德钰科技股份有限公司	2020.10.16-2023.10.15	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是
		2020.10.16-2023.10.15	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	是
		2023.10.16-2026.10.15 注1	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否
	合肥捷达微电子有限公司	2018.03.16-2021.03.15	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是
		2021.03.16-2024.03.15	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是
		2020.08.01-2023.07.31 注2	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	否
2	联咏科技股份有限公司	2018.02.22-2021.02.21	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是
		2020.12.10-2023.12.09	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是
3	奇景光电股份有限公司	2018.07.01-长期	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否
		2013.11.10-长期	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	否
4	瑞鼎科技股份有限公司	2020.01.01-2022.12.31 注3	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是
		2020.01.01-2022.12.31 注3	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	是
		2023.01.01-2024.12.31	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否
		2023.01.01-2024.12.31	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	否
5	矽创电子股份有限公司	2019.01.01-长期	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否
		2016.12.18-长期	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	否
6	深圳市爱协生科技股份有限公司	2020.03.05-2023.03.04	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是
		2020.03.05-2023.03.04	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是

		2020.03.05-2023.03.04	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是
		2023.03.05-2026.03.04	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否
		2023.03.05-2026.03.04	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否
		2023.03.05-2026.03.04	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否
		2023.03.05-2026.03.04	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	否
		2023.03.05-2026.03.04	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	否
		2023.03.05-2026.03.04	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	否
7	北京集创北方科技股份有限公司	2021.01.01-2022.12.31	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是
		2023.01.01-2024.12.31	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否
8	奕力科技股份有限公司	2020.08.01-2023.07.31	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	是
		2023.08.01-2026.07.31	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	否

注 1：根据合同相关约定，汇成股份与天德钰签订的框架合同内容已包含江苏汇成，因此未再单独与江苏汇成签订框架合同。

注 2：根据合同相关约定，江苏汇成与合肥捷达微电子有限公司原框架合同继续延展。

注 3：根据合同相关约定，发行人与瑞鼎原框架合同效力延展一年。

2、采购合同

（1）原材料采购合同

报告期内，发行人及其子公司与原材料供应商通过订单方式交易，并根据需求下原材料采购订单，原材料供应商根据订单组织生产。截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司与供应商签订的已履行完毕或正在履行的金额在 1,000 万元以上的原材料采购订单的相关情况如下：

序号	合同对方	合同金额	签订日期	采购主要内容	是否履行完毕
1	光洋化学	1,163.59 万元	2021.01.29	金盐	是
2	光洋化学	1,245.20 万元	2021.03.12	金盐	是
3	光洋化学	1,661.95 万元	2021.04.26	金盐	是

4	光洋化学	1,878.21 万元	2021.05.25	金盐	是
5	光洋化学	2,245.09 万元	2021.07.21	金盐	是
6	光洋化学	1,188.55 万元	2021.10.19	金盐	是
7	光洋化学	1,437.87 万元	2021.11.19	金盐	是
8	光洋化学	1,759.91 万元	2021.12.21	金盐	是
9	光洋化学	1,594.40 万元	2022.01.20	金盐	是
10	光洋化学	1,650.91 万元	2022.03.03	金盐	是
11	光洋化学	1,026.78 万元	2022.04.29	金盐	是
12	光洋化学	1,839.27 万元	2022.05.06	金盐	是
13	光洋化学	1,181.67 万元	2022.06.21	金盐	是
14	光洋化学	1,285.20 万元	2022.07.20	金盐	是
15	光洋化学	1,700.33 万元	2022.08.16	金盐	是
16	光洋化学	1,401.14 万元	2022.09.14	金盐	是
17	光洋化学	1,155.14 万元	2022.10.20	金盐	是
18	光洋化学	1,535.47 万元	2022.11.22	金盐	是
19	光洋化学	1,455.97 万元	2023.01.06	金盐	是
20	光洋化学	1,712.77 万元	2023.02.01	金盐	是
21	光洋化学	1,284.14 万元	2023.03.02	金盐	是
22	光洋化学	2,131.82 万元	2023.03.22	金盐	是
23	光洋化学	3,352.62 万元	2023.04.11	金盐	是
24	光洋化学	1,642.21 万元	2023.06.02	金盐	是

25	光洋化学	2,198.05 万元	2023.07.05	金盐	是
26	光洋化学	2,730.69 万元	2023.08.18	金盐	是
27	光洋化学	3,029.68 万元	2023.09.14	金盐	是
28	光洋化学	2,602.40 万元	2023.10.31	金盐	是
29	光洋化学	2,119.86 万元	2023.12.05	金盐	是
30	光洋化学	2,706.58 万元	2023.12.28	金盐	是
31	光洋化学	1,904.28 万元	2024.01.26	金盐	是
32	光洋化学	2,977.19 万元	2024.03.11	金盐	是
33	光洋化学	1,546.01 万元	2024.04.18	金盐	是
34	田中贵金属	18,407.70 万日元	2021.07.09	含金电镀液 电镀亚硫酸金补充剂	是
35	田中贵金属	25,691.76 万日元	2021.04.15	含金电镀液 电镀亚硫酸金补充剂	是
36	田中贵金属	34,320.91 万日元	2022.02.15	含金电镀液 电镀亚硫酸金补充剂	是
37	田中贵金属	21,171.33 万日元	2024.03.14	含金电镀液 电镀亚硫酸金补充剂	是
38	田中贵金属	23,386.94 万日元	2024.04.02	含金电镀液 电镀亚硫酸金补充剂	否
39	美泰乐科技（苏州）有限公司	1,335.34 万元	2022.01.11	含金电镀液 电镀亚硫酸金补充剂	是

（2）设备采购合同

报告期内，发行人及其子公司与设备供应商通过订单方式交易，并根据需求下设备采购订单。截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司与设备供应商签订的已履行完毕或正在履行的金额在 3,000 万元以上的设备采购订单的相关情况如下：

序号	合同对方	合同金额	签订日期	采购主要内容	是否履行完毕
1	ADVANTEST CORPORATION	170,680.00 万日元	2021.02.03	测试机	是

2	ADVANTEST CORPORATION	170,680.00 万日元	2021.11.11	测试机	是
3	ADVANTEST CORPORATION	170,680.00 万日元	2021.11.14	测试机	是
4	ADVANTEST CORPORATION	129,510.00 万日元	2022.12.05	测试机	是
5	ADVANTEST CORPORATION	170,680.00 万日元	2023.05.23	测试机	是
6	ADVANTEST CORPORATION	128,010.00 万日元	2023.07.03	测试机	否
7	ADVANTEST CORPORATION	67,500.00 万日元	2023.07.03	测试机	是
8	ADVANTEST CORPORATION	67,500.00 万日元	2023.07.27	测试机	是
9	Xcerra Corporation	736.00 万美元	2022.02.15	测试机	是
10	ADVANTEST CORPORATION	86,340.00 万日元	2023.08.22	测试机	是
11	TOKYO SEIMITSU CO., LTD	66,310.00 万日元	2023.08.04	探针台	是
12	迪思科科技（中国）有限公司	569.55 万美元	2023.09.28	晶圆切割机	是
13	ADVANTEST CORPORATION	141,800.00 万日元	2024.03.14	测试机	否

3、授信及借款合同

截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司正在履行的累计借款余额超过 5,000 万元的重大金融机构授信合同以及单笔金额超过 5,000 万元的借款合同情况如下：

序号	合同名称	借款人	授信方/贷款方	授信/借款金额 (万元)	合同约定授信/借款期限
1	《授信协议》	汇成股份	招商银行股份有限公司合肥分行	25,000.00	2023.09.08-2026.09.07
2	《固定资产借款合同》	江苏汇成	中国银行股份有限公司扬州邗江支行	20,000.00	2024.01.23-2030.01.22

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司上述重大合同合法有效，均正常履行，不存在重大法律风险。

（二）经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动用工、安全生产、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）经核查，除本补充法律意见书正文“九、关联交易及同业竞争”之“（二）关联交易”所披露的关联交易外，发行人报告期内与关联方之间不存在其他重大债权债务关系，不存在其他为关联方提供担保的情形。

（四）根据《审计报告》，发行人报告期内发生的金额较大的其他应收款、其他应付款均系因正常的经营活动发生，合法、有效。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

（一）发行人的增资扩股

经核查，补充核查期间，发行人未发生增资扩股情形。

（二）发行人合并、分立、减少注册资本

经核查，补充核查期间，发行人不存在合并、分立、减少注册资本的行为。

（三）发行人的重大资产收购及出售

经核查，补充核查期间，发行人不存在重大资产收购及出售的行为。

（四）拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为

经核查，补充核查期间，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十三、发行人章程的制定与修改

经核查，补充核查期间，发行人章程的制定与修改有关事项未发生变化。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人具有健全的组织机构

经核查，发行人已根据《公司法》《公司章程》等规定建立了股东大会、董事会（下设专门委员会）、监事会、经营管理层等健全的组织机构。

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

经核查，发行人制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议

事规则》等公司治理制度，上述股东大会、董事会和监事会的议事规则符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

（三）发行人自股份公司设立以来的历次股东大会、董事会、监事会的召开情况

经核查，自《律师工作报告》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人共召开 1 次股东大会、10 次董事会会议、10 次监事会会议。经核查，本所律师认为，发行人上述董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（四）经核查，发行人自股份公司设立以来的股东大会或董事会的历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

（一）发行人现任董事、监事和高级管理人员及其任职资格

1、董事

发行人现有董事会由 7 名董事（包括 3 名独立董事）组成，分别为郑瑞俊、沈建纬、赵亚彬、吴海龙、杨辉、程敏、蔺智挺，其中郑瑞俊为董事长，杨辉、程敏、蔺智挺为独立董事。前述董事会成员除独立董事蔺智挺由 2020 年年度股东大会选举产生外，其余董事均由发行人创立大会暨首次股东大会选举产生。董事长由发行人第一届董事会第一次会议选举产生。

2、监事

发行人现有监事会由 3 名监事组成，分别为郭小鹏、陈殊凡、程红艳，郭小鹏为监事会主席。监事郭小鹏由发行人 2023 年第三次临时股东大会选举产生，监事陈殊凡由发行人 2022 年年度股东大会选举产生，职工代表监事程红艳由发行人 2021 年 3 月 15 日召开的职工代表大会选举产生，监事会主席由发行人第一届监事会第十六次会议选举产生。

3、高级管理人员

发行人现有高级管理人员 7 名，即总经理郑瑞俊，副总经理林文浩、钟玉玄、马行天、黄振芳，董事会秘书奚颢，财务总监闫柳，总经理郑瑞俊及副总经理林文浩、钟玉玄、马行天由发行人第一届董事会第一次会议聘任产生，副总经理黄振芳由发行人第一届董事会第十六次会议聘任产生，董事会秘书奚颢由发行人第一届董事会第十四次会议聘任产生，财务总监闫柳由发行人第一届董事会第十二次会议聘任产生。

经核查，发行人的董事、监事和高级管理人员的任职均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改的情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况。

截至本补充法律意见书出具日，公司董事会、监事会换届事宜尚待公司股东大会通过，为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照相关规定履行职责。公司高级管理人员将由新一届董事会成员确定后进行聘任。

（二）报告期内发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变化情况

本所律师已在《律师工作报告》中论述了报告期内发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变化情况。截至本补充法律意见书出具日，新增变化情况如下：

2023 年 11 月，原监事杨欢辞去监事会主席、非职工代表监事职务，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会选举郭小鹏为公司第一届监事会非职工代表监事。

（三）发行人独立董事情况

本所律师已在《律师工作报告》中论述了发行人独立董事情况。截至本补充法律意见书出具日，发行人独立董事情况有关事项没有发生变化。

十六、发行人的税务

（一）主要税种及税率

根据《审计报告》，补充核查期间，发行人及其子公司执行的主要税种及适用的税率未发生变化。

（二）报告期内的税收优惠

1、发行人税收优惠

汇成股份于 2019 年 11 月 20 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201934001917，有效期 3 年），按税法规定 2019-2021 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

汇成股份于 2022 年 10 月 18 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202234004596，有效期 3 年），按税法规定 2022-2024 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳税增值税税额。

2、江苏汇成税收优惠

江苏汇成于 2021 年 12 月 15 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202132011450，有效期 3 年），按税法规定 2021-2023 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额。

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司报告期内享受的上述税收优惠政策符合有关法律、法规及规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

（三）财政补贴

根据《审计报告》《非经常性损益的鉴证报告》并经本所律师核查，2023年，发行人及其子公司享受的财政补贴情况如下：

项目	金额（元）	说明
新站区研发补贴	7,225,769.83	《合肥新汇成微电子有限公司“金凸块封装、测试基地”项目“借转补”资金使用协议书》
2022年度合肥市外贸促进政策资金	2,231,362.00	《关于支持重点企业申请提质增效奖补资金的通知》
安徽省集成电路产业政策资金	3,835,461.81	《关于开展支持集成电路产业加快创新发展若干政策相关项目申报工作的通知》《关于开展2021年支持工业互联网发展若干政策资金项目申报工作的通知》《合肥市发展改革委合肥市财政局关于印发合肥市加快推进集成电路产业发展若干政策实施细则的通知》
合肥市工业发展政策项目补助	3,704,411.95	《合肥市经济和信息化委员会关于印发2018年工业发展政策操作规程的通知》《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》《关于印发〈2019年合肥市支持先进制造业发展政策操作规程〉的通知》《关于印发2020年合肥市支持先进制造业发展政策操作规程的通知》
国家专精特新“小巨人”企业奖补	1,000,000.00	《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省专精特新中小企业倍增行动方案的通知》
扬州经济技术开发区管委会综合保税区管理局地方经济贡献奖	658,530.35	扬州综保区协议
合肥市先进制造业发展政策补助资金	553,546.72	《关于印发2020年合肥市支持先进制造业发展政策操作规程的通知》
2022年邗江区工业经济高质量发展专	348,951.41	《关于组织申报2022年度邗江区工业经济高质量发展及技术改造专项资金项目的通知》

项资金		
合肥市经信局研发设备补助	473,125.94	《关于开展支持集成电路产业加快创新发展若干政策相关项目申报工作》
支持企业上市奖励	370,000.00	《安徽省财政厅关于印发<省级财政支持多层次资本市场发展奖补办法>的通知》
扩岗、稳岗补贴	353,165.26	《国务院办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅 财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》《江苏省人力资源和社会保障厅 江苏省教育厅 江苏省财政厅关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》《扬州市人民政府办公室关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》
扬州市级先进制造业发展引导资金	352,701.12	《关于组织申报 2018 年度市级先进制造业发展引导资金的通知》《关于组织申报 2019 年度市级先进制造业发展引导资金项目的通知》《关于下达 2020 年市级先进制造业发展引导资金的通知》
新站区经贸发展局“三重一创”	331,121.88	《安徽省人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》
2022 年度市知识产权奖补资金	125,000.00	扬邗市监[2022]39 号、《关于确定 2021 年度扬州市知识产权优势企业的通知》《关于组织申报 2022 年度扬州市企业知识产权战略推进计划项目的通知》
高新技术企业奖励	80,000.00	《关于申报 2021 年度高新技术企业的通知》
2023 年度知识产权专项资金	70,000.00	扬邗市监〔2023〕63 号
2021 年科技型企业市级认定研发费用补助资金	50,200.00	《市政府印发关于实施创新驱动发展战略加强产业科创名城科技支撑政策措施的通知》
2018 年安徽省制造强省建设资金项目	167,068.92	《安徽省人民政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知》
2020 年邗江区高质量发展专项资金	107,009.17	《关于组织申报 2020 年度全区工业经济高质量发展专项资金项目的通知》
2023 年中央外经贸发展专项资金	80,000.00	《安徽省外经贸发展专项资金管理办法》
2018 年扬州科技发展计划项目专项资金	75,555.60	《扬州市市级科技专项资金管理办法》、扬州市科技计划项目合同
扬州市高新区管委会创新积分奖励	50,000.00	扬开管发〔2022〕174 号
科技创新政策补助	37,204.00	合科〔2023〕20 号

新站区环保设备改造补贴	36,000.00	合新环发〔2019〕1号
绿色金融奖补资金	5,993.00	《江苏省生态环境厅 江苏省财政厅关于组织申报2022年度江苏省绿色金融奖补资金的通知》
贷款贴息	1,102,200.00	《安徽省发展改革委安徽省财政厅中国人民银行合肥中心支行银保监会安徽监管局关于开展2023年度省制造业融资财政贴息专项资金“免申即享”的通知》
其他	11,635.98	-
小计	23,436,014.94	-

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司享受的上述财政补贴政策合法、合规、真实、有效。

（四）发行人依法纳税的情况

经核查，补充核查期间，发行人及其子公司依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人的环境保护和产品质量、技术标准相关内容。经核查，截至本补充法律意见书出具日，除募投项目的环保审批外，发行人的环境保护和产品质量、技术标准其他有关事项未发生变化，募投项目的环保审批具体情况如下：

序号	项目名称	环保审批情况
1	12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	已于2023年10月8日取得合肥市生态环境局出具的“环建审〔2023〕12038号”环评批复
2	12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	已于2023年10月20日取得扬州市生态环境局出具的“扬环审批〔2023〕05-51号”环评批复

十八、发行人募集资金的运用

（一）发行人本次募集资金投资项目

1、募集资金投资项目

根据发行人2023年第二次临时股东大会及第一届董事会第二十二次会议决

议，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 114,870.00 万元（含 114,870.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	47,611.57	35,000.00
2	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	56,099.47	50,000.00
3	补充流动资金	35,000.00	29,870.00
合计		138,711.04	114,870.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

2、募集资金投资项目的立项、土地、环保等有关报批事项

上述募集资金投资项目经发行人第一届董事会第十七次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并已完成政府有关部门备案，具体情况如下：

（1）发行人“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”在合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号现有厂房进行建设，汇成股份已取得本项目建设地的不动产权证书。

本项目已在合肥新站高新技术产业开发区经贸局备案，项目代码为 2306-34 0163-04-05-470278，已取得环评批复（环建审（2023）12038 号），项目地址为安徽省合肥市新站高新技术产业开发区综合保税区内项王路 8 号。

（2）发行人“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”在江苏省扬州市高新区金荣路 19 号现有厂房进行建设，江苏汇成已取得本

项目建设地的国有土地使用证及房屋所有权证。

本项目已取得扬州市邗江区工业和信息化局出具的《江苏省投资项目备案证》，项目代码为 2306-321003-07-02-182816，已取得环评批复（扬环审批〔2023〕05-51 号），项目地址为扬州市邗江区扬州高新区金荣路 19 号。

（二）根据发行人为募集资金投资项目编制的可行性分析报告及《募集说明书》，并经本所律师核查，发行人本次发行募集资金有明确的使用方向，均围绕主营业务进行，投资于科技创新领域。募集资金金额和投资方向与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水准和管理能力及未来资本支出规划等相适应，符合国家产业政策，不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业、高耗能、高排放行业，募集资金投资后未新增过剩产能或投资于限制类、淘汰类项目。

（三）经核查，上述募集资金投资项目均由发行人或其全资子公司实施。

（四）经核查，发行人第一届董事会第十七次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，发行人第一届董事会第二十二次会议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案，发行人董事会、股东大会对募集资金使用计划、运用具体情况等方面进行了详细分析。

（五）经核查，发行人已制定了《募集资金管理制度》并经发行人 2022 年年度股东大会审议通过。

十九、发行人业务发展目标

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人业务发展目标。经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人业务发展目标未发生变化。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在尚未了结的或可预见

的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改的情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况。

（二）经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的控股股东、实际控制人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的控股股东、实际控制人不存在被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改的情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况。

（三）经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人董事长、总经理郑瑞俊不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

二十一、发行人募集说明书法律风险的评价

本所律师已查阅了《募集说明书》，特别对该《募集说明书》中引用《法律意见书》《律师工作报告》及本补充法律意见书的相关内容进行了认真审阅，并予以确认；对发行人《募集说明书》的其他内容，根据发行人董事、发行人保荐机构（主承销商）及有关中介机构的书面承诺和确认，该内容不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险。

二十二、其他需说明的事项

（一）优先股

经核查，发行人本次发行为向不特定对象发行可转换公司债券，不适用优先股相关发行条件。

（二）财务性投资

1、公司 2023 年末及 2024 年 3 月末的财务性投资情况

截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，发行人财务性投资金额均为 5,000.00 万元，拟持有的财务性投资金额为 130.00 万元，系公司参与设立产业基金形成的权益性投资，具体情况参见本补充法律意见书“二十二、其他需说明的事项”之“（二）财务性投资”之“3、自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资”。

截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计均为 5,130.00 万元，占 2023 年末和 2024 年 3 月末公司合并报表归属于母公司净资产的比例分别为 1.64% 和 1.66%，占比较小，不存在已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十的情形，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

2、公司最近一期末持有的金融产品不属于财务性投资

（1）2023 年末

经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有的金融产品具体情况如下：

序号	机构名称	产品名称	类型	起息日/受让日	到期日	本金余额 (万元)
1	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利 10 期浮动收益凭证	本金保障型	2023.06.19	2024.01.04	2,000.00
2	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022.09.30	2024.08.25	1,000.00
3	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022.11.23	2025.06.10	5,000.00
4	杭州银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2023.01.18	2025.06.24	3,000.00
5	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022.11.23	2025.07.07	3,000.00
6	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022.09.30	2025.07.28	1,000.00
合计						15,000.00

如上表所示，截至 2023 年末发行人持有的金融产品风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，不属于财务性投资。

（2）2024 年 3 月末

截至 2024 年 3 月末，公司持有的金融产品具体情况如下：

序号	机构名称	产品名称	类型	起息日/ 受让日	到期日	本金余额 (万元)
1	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利 52 期浮动收益凭证	本金保障型	2024.03.25	2024.06.25	2,000.00
2	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022.09.30	2024.08.25	1,000.00
3	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022.11.23	2025.06.10	5,000.00
4	杭州银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2023.01.18	2025.06.24	3,000.00
5	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022.11.23	2025.07.07	3,000.00
6	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022.09.30	2025.07.28	1,000.00
合计						15,000.00

如上表所示，截至 2024 年 3 月末发行人持有的金融产品风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，不属于财务性投资。

3、自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资

发行人本次发行的董事会决议日为 2023 年 6 月 16 日，决议日前六个月至本补充法律意见书出具日，公司已实施或拟实施的财务性投资为 5,130.00 万元，具体情况如下：

2023 年 11 月 1 日，发行人召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的议案》，发行人作为有限合伙人以自有资金认缴晶汇聚芯出资人民币 5,000 万元，并作为有限合伙人以自有资金认缴晶汇聚芯普通合伙人晶合汇信出资人民币 130 万元。基于谨慎性原则，发行人已将前述合计 5,130.00 万元投资认定为本次发行相关董事会决议日前六个月至今新增的财务性投资。经发行人第一届董事会第二十二次会议审议，前述财务性投资金额 5,130.00 万元已从本次募集资金总额中扣除。截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司认缴的晶汇聚芯出资额 5,000.00 万元已全部实缴，认缴的晶合汇信出资额 130.00 万元尚未实缴；截至本补充法律意见书出具日，前述认缴的晶合汇信出资额 130.00 万元已全部实缴。

综上，本所律师认为，发行人符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第一

条的相关要求。

（三）类金融业务

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在从事类金融业务的情况。

二十三、结论意见

综上，本所律师认为，发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的条件。发行人本次发行尚需中国证监会同意注册。

（以下无正文）

[本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（五）》签署页]

本法律意见书于 2024 年 5 月 13 日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本四份，无副本。



负责人：卢贤榕 卢贤榕

经办律师：卢贤榕 卢贤榕

陈磊 陈磊

孙静 孙静